

รายงานการวิจัย

ตู้อบแห้งอุณหภูมิต่ำ

Low temperature drying oven



จัดทำโดย

รศ. ดร. วันชัย ธีรรัฐจา

ภาควิหาระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

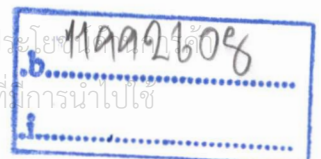
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

RC4
TP
363
2426๓

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 84477
วัน,เดือน,ปี..... 13 ต.ค. 2551

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) “เครื่องอบแห้งอุณหภูมิต่ำ”
(ภาษาอังกฤษ) “Low temperature drying oven”

ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย) รศ. ดร. วันชัย รีวรุจา
(ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Vanchai Riewruja

หน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัย และที่อยู่

แผนก/ภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม กอง/คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรม/มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระทรวง/ทบวง กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0-2739-0758 โทรสาร 0-2739-0758

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี.....2549..... จำนวนเงิน.....325,000.....บาท
ระยะเวลาการทำการวิจัย.....1.....ปี ตั้งแต่....1..ตุลาคม..2548....ถึง....30..กันยายน..2549

บทคัดย่อ

ในโครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องอบแห้งบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากแผ่นทำความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริกในการดึงความชื้นออกจากอากาศภายในตู้อบ ความชื้นของผลิตภัณฑ์จะระเหยสู่อากาศหมุนเวียนในตู้อบและควบแน่นเป็นหยดน้ำ ค่าอุณหภูมิและความชื้นในตู้อบถูกนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแผ่นทำความเย็นเพื่อให้ได้จุดควบแน่นโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งอุณหภูมิภายในตู้อบจะถูกควบคุมให้ไม่สูงเกิน 50°C.

ABSTRACT

This research project proposes a method to develop drying oven. The technique is based on the use of the hot/cool plate of the thermoelectric to condense the vapor of the circulated air in the chamber. Humidity of product is evaporated to the circulated air and condensed into the water drop. The optimal temperature of the hot/cool plate for dew point is calculated from temperature and humidity in the chamber by microcontroller. Temperature in the chamber is controlled below 50°C.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้การสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยครั้งนี้

รศ. ดร. วันชัย ธีรรัฐจา



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
กล่าวนำ	1
แนววิจัย	2
การดำเนินการวิจัย	3
ผลการทดลอง	8
สรุป	9
เอกสารอ้างอิง	10
ภาคผนวก ก เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ	11
ก.1 ไฟล์ชาร์ตการทำงานของเครื่อง	11
ก.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง	12
ก.3 โปรแกรม	14
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิ SHT15	33

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงการวิจัยเรื่อง ตู้อบแห้งอุณหภูมิต่ำ

กล่าวนำ

ปัจจุบันการอบแห้งเข้ามามีบทบาทในทางการเกษตรและอาหารมากขึ้น เนื่องจากการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาให้นานยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดเก็บรักษาและการรับประทาน หัวใจสำคัญสำหรับกรรมวิธีการอบแห้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ การลดระยะเวลาของการอบแห้งไปพร้อมๆ กับการรักษาหรือเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยทั่วไปนิยมการอบแห้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยกัน 2 แบบ คือ การอบแห้งแบบแช่แข็ง และการอบแห้งแบบใช้ลมร้อน

การอบแห้งแบบแช่แข็ง คือ วิธีการอบแห้งที่ทำให้ส่วนประกอบที่เป็นน้ำในผลิตภัณฑ์เกิดการแข็งตัวโดยใช้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง แล้วทำการระเหิดน้ำที่เกิดการแข็งตัวนั้นออก ซึ่งการระเหิดนั้นจะกระทำภายในระบบสุญญากาศที่ความดันสัมบูรณ์ประมาณ 100 ปาสคาล ลักษณะเด่นของการอบแห้งแบบแช่แข็งมีดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์มีน้อย เนื่องจากการอบแห้งที่อาศัยการระเหิดของน้ำออกในสภาวะเยือกแข็งที่อุณหภูมิต่ำ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีการเสื่อมสภาพและสูญเสียองค์ประกอบที่ระเหยง่ายเหมือนกับการใช้ความร้อน
- สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งแล้วนั้นกลับคืนสู่สภาพก่อนอบแห้งได้ง่าย โดยการเติมน้ำให้ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง เนื่องจากการกำจัดส่วนประกอบน้ำในสภาวะเยือกแข็งมีผลให้ผลิตภัณฑ์อบแห้งมีรูปทรงจำนวนมาก

แต่การอบแห้งแบบแช่แข็งนี้มีข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลายาวนานในการอบแห้ง เนื่องจากการอบแห้งเกิดที่อุณหภูมิต่ำ อัตราการอบแห้งจึงช้ามาก และมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับการอบแห้งด้วยวิธีอื่น เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้มีมูลค่าสูง

การอบแห้งแบบใช้ลมร้อน คือ การใช้ลมร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำหนึ่งซึ่งมีค่ามากกว่า 50 °C ให้กับอากาศในตู้อบ เมื่ออากาศในตู้อบได้รับความร้อนจะเป็นผลทำให้เกิดการระเหยเป็นไอของไอน้ำในอากาศจึงทำให้ความชื้นในอากาศลดลง เมื่อความชื้นในอากาศลดลงอากาศจะดึงความชื้นของผลิตภัณฑ์ออกมาแทนเพื่อรักษาความชื้นในตู้อบให้สมดุล ดังนั้นวิธีการอบแห้งแบบนี้จะมีปัจจัยอยู่หลายอย่าง เช่น ความชื้นในตู้อบขณะนั้น การคายความชื้นของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและการดูดความร้อนของผลิตภัณฑ์ และความเร็วมวลที่ไหลเวียนในตู้อบ ซึ่งการอบแห้งด้วยวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยกว่าแบบแช่แข็ง มูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างตู้อบรวมทั้งพลังงานที่ใช้ในการสร้างลมร้อนต่ำกว่า แต่การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำนี้จะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง เช่น การสูญเสียของสารระเหยง่าย การแปรสภาพของโปรตีน หรือการแปรสภาพของวิตามิน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากปัจจัยของการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ต้องคำนึงต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงทำการศึกษาและสร้างต้นแบบตู้อบแห้งอุณหภูมิต่ำ โดยตู้อบแห้งที่ออกแบบนั้นจะใช้ลมร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 °C เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเลือกสร้างด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดเพื่อราคาค่าต้นทุนของตู้อบแห้งมีค่าใช้จ่ายต่ำ

แนวทางวิจัย

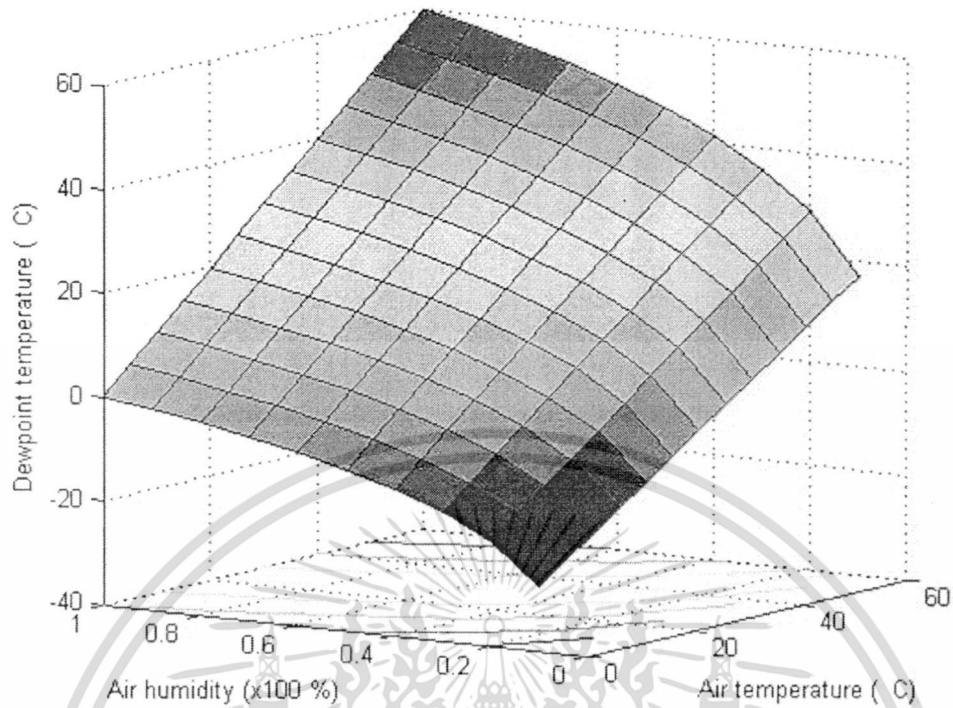
การอบแห้งโดยไม่ใช้ความร้อนที่สูงกว่า 50°C เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคายความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งนั้น ปัจจุบันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องน้อยมาก โดยทั่วไปจะเป็นหลักการของการอบแห้งโดยใช้ความร้อนที่สูงทั้งสิ้น ดังนั้นในการดำเนินการวิจัยจึงได้เริ่มต้นจากการศึกษาการดึงความชื้นออกจากอากาศก่อน เพื่อสร้างอากาศที่ไม่มีความชื้นหรืออากาศแห้ง หลังจากนั้นจะนำพาอากาศแห้งที่ได้ไหลผ่านผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้ง อากาศแห้งที่ไหลผ่านจะดูดความชื้นจากผลิตภัณฑ์ออกมา ทำให้ความชื้นของผลิตภัณฑ์ค่อยๆ ลดลงตามที่ต้องการ การดึงความชื้นออกจากอากาศนั้นจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะของไอน้ำในอากาศจากรูปของไอเป็นของเหลว หรือจากรูปของไอน้ำมาเป็นหยดน้ำ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดจากการถ่ายพลังงานความร้อนแฝงของไอน้ำในอากาศห้องปิดที่มีอุณหภูมิสูงกับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศที่ต้องการดึงความชื้นออก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และอุณหภูมิที่เกิดการควบแน่นสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$T_c = \frac{237.7f(T, RH)}{17.27 - f(T, RH)} \quad (1)$$

$$f(T, RH) = \frac{17.27T}{237.7 + T} + \ln RH \quad (2)$$

เมื่อ T คือ อุณหภูมิของอากาศ
 T_c คือ อุณหภูมิที่เกิดการควบแน่น
 RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่เกิดการควบแน่น อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของ T_c , T และ RH

เมื่อทำการดึงความชื้นออกจากอากาศจนอากาศในห้องปิดเป็นอากาศแห้งแล้ว จะทำการปล่อยอากาศแห้งให้ไหลผ่านผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้ง อากาศแห้งนี้จะทำหน้าที่ดึงความชื้นให้ออกจากผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์แห้งแบบธรรมชาติ แต่ใช้เวลาที่น้อยกว่า

การดำเนินการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ ในลำดับแรกทางโครงการได้ทำการศึกษาแนวทางในการดึงความชื้นจากอากาศในสภาวะอุณหภูมิปกติ โดยศึกษาจากจุดควบแน่นของไอน้ำในอากาศด้วยการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องขึ้นเอง เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สำเร็จรูปจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ระบบและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นประกอบ 2 ส่วน ดังนี้

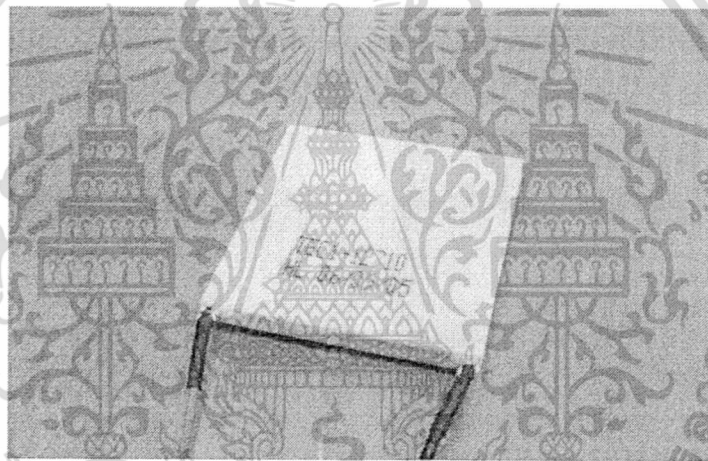
- ระบบสร้างความเย็น โดยใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
- ชุดวัดค่าและบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิ

1. ระบบสร้างความเย็นโดยใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

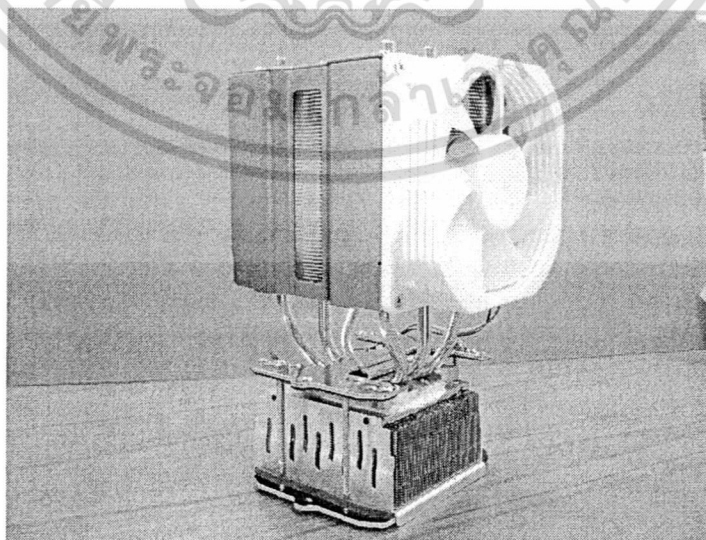
ระบบสร้างความเย็นจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศ จนทำให้ไอน้ำที่ปนอยู่ในอากาศนั้นเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ ซึ่งโครงการนี้เลือกใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความเย็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อป้อนไฟฟ้าเข้าที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองจะทำให้ด้านหนึ่งของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกอุณหภูมิจะเย็นลง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของแผ่นอุณหภูมิจะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น เมื่อผู้ใดได้เห็นใบเซปหรือเอกสารนี้แล้ว กรุณาอย่าเผยแพร่หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ร้อนขึ้น การทำงานของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกจะอาศัยปรากฏการณ์ของ Peltier ที่กล่าวว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสารกึ่งตัวนำสองชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิดพี และสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ที่ประกอบอยู่ระหว่างแผ่นเซรามิก เมื่อกระแสไฟฟ้าจากสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นไหลไปยังสารกึ่งตัวนำชนิดพีจะทำให้อุณหภูมิที่จุดต่อของทั้งสองสารลดลง เป็นผลทำให้เกิดการดูดความร้อนจากอากาศบริเวณรอบข้าง ความร้อนที่จุดคู่นั้นจะถูกพาไปโดยประจุอิเล็กตรอนของกระแสไฟฟ้า และนำพามาปล่อยที่ด้านตรงข้าม ประสิทธิภาพการดูดความร้อนขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้า จำนวนชั้นของสารกึ่งตัวนำชนิดพีและชนิดเอ็น และการถ่ายเทความร้อนของผิวสัมผัส สำหรับโครงการวิจัยนี้จะนำแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกมาออกแบบเป็นระบบสร้างความเย็นดังรูปที่ 3 โดยด้านที่สร้างความเย็นหรือดูดความร้อน จะมีแผ่นระบายความร้อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดึงอุณหภูมิหรือเป็นส่วนที่จะใช้ดึงความชื้นออกจากอากาศ (อยู่ในรูปของหยดน้ำ) และส่วนอีกด้านหนึ่งจะติดชุดระบายความร้อนที่จุดมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเย็นของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก



รูปที่ 2 แผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก



รูปที่ 3 ระบบสร้างความเย็นโดยใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ชุดวัดค่าและบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิ

ในการศึกษาหาจุดควบแน่นของไอน้ำในอากาศ ทางโครงการวิจัยนี้จึงต้องสร้างชุดวัดค่าและบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิขึ้น ดังแสดง โครงสร้างของเครื่องไว้ในรูปที่ 4 และเครื่องวัดค่าและบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิที่ได้สร้างดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งชุดนี้จะประกอบด้วยโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877, หัววัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ, จอแสดงผลแบบผลึกเหลว และหน่วยความจำภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วนดังนี้

- ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877

ทำหน้าที่เป็นหน่วยอ่านค่าจากหัววัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ แล้วนำมาแสดงผลบนจอแสดงผลแบบผลึกเหลวพร้อมทั้งนำไปบันทึกค่าในหน่วยความจำภายนอก

- หัววัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ

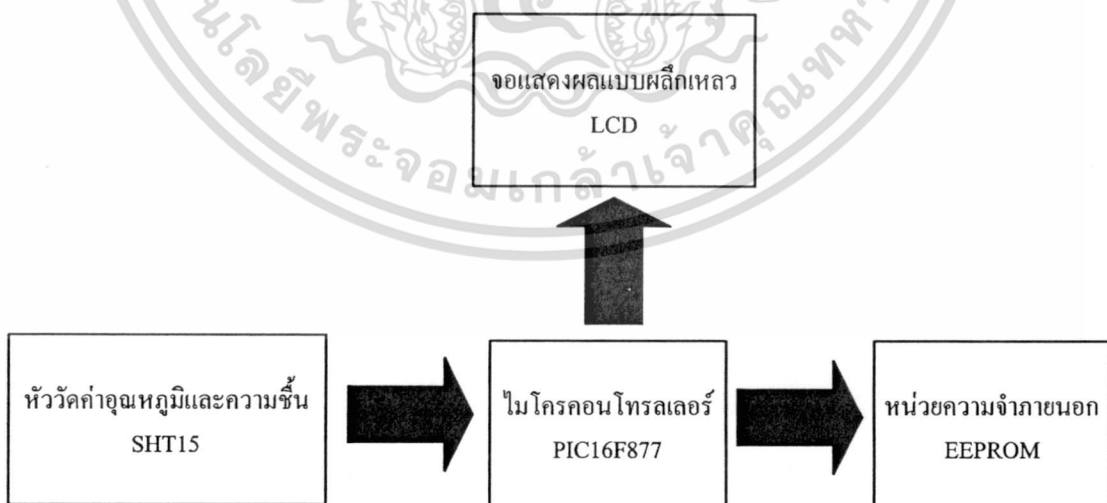
ใช้หัววัดค่าความชื้นและอุณหภูมิสำเร็จรูปเบอร์ SHT15 ของบริษัท sensirion ซึ่งเป็นหัววัดที่ให้ค่าความชื้นและอุณหภูมิออกมาในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสะดวกในการเชื่อมต่อ ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข.

- จอแสดงผลแบบผลึกเหลว

ใช้แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิที่อ่านได้จากหัววัดค่า เลือกใช้จอแสดงผลแบบผลึกเหลว หรือเรียกย่อว่า LCD ซึ่งสะดวกในการแสดงผล

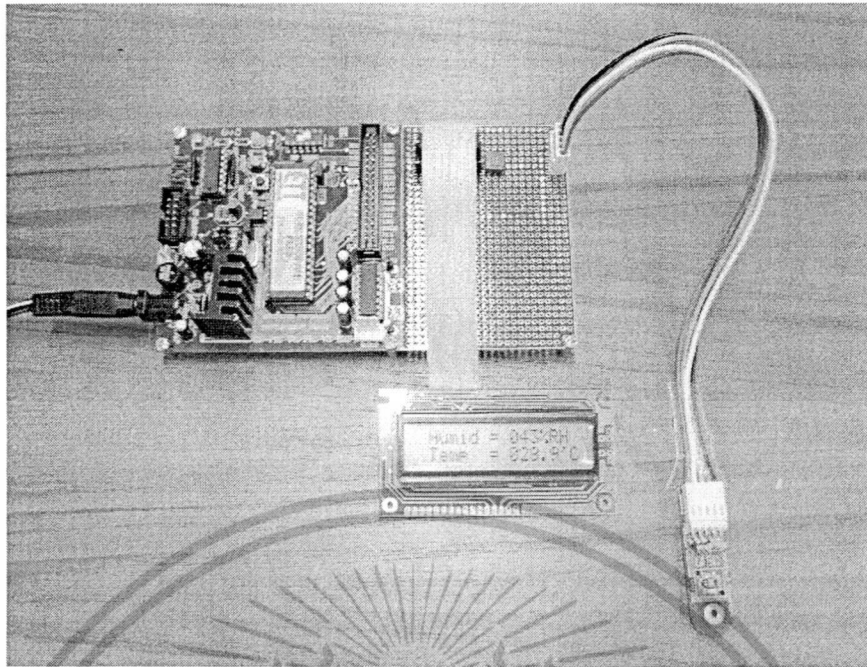
- หน่วยความจำภายนอก

ใช้บันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิที่อ่านได้เพื่อสามารถย้อนกลับมาอ่านค่าได้ โดยใช้หน่วยความจำแบบ EEPROM ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้แม้จะไฟดับ



รูปที่ 4 โครงสร้างชุดอ่านค่าและบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5 ชุดอ่านค่าและบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น

สำหรับการศึกษาหาจุดควบแน่นของไอน้ำในอากาศ ทางโครงงานวิจัยนี้ นำระบบสร้าง ความเย็นด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกมาสร้างเป็นระบบที่ใช้ดูดความชื้นจากอากาศภายในระบบ ปิด โดยจะกำหนดความชื้นในระบบให้คงที่ แล้วทำการบันทึกค่าอุณหภูมิก่อนผ่านแผ่นระบาย ความร้อนที่ติดอยู่กับแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกกับอุณหภูมิที่แผ่นระบายความร้อน ณ จุดที่ควบแน่น ของไอน้ำในอากาศ (เกิดหยดน้ำบนแผ่นระบายความร้อน) เพื่อหาอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการควบแน่น ซึ่งได้ทำการกำหนดค่าความชื้นของระบบให้คงที่ไว้จำนวน 9 ค่า ตั้งแต่ 20% ถึง 60%RH โดยเพิ่มทีละ 5% และทำการเปลี่ยนค่าอุณหภูมิในระบบตั้งแต่ 30°C ถึง 50°C โดยเพิ่มทีละ 2°C ตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิที่แผ่นระบายความร้อนหรืออุณหภูมิที่ระบบสร้างความเย็นต้องสร้างเพื่อให้เกิด หยดน้ำหรือจุดควบแน่นของไอน้ำในอากาศ ณ อุณหภูมิและความชื้นของระบบตามที่กำหนดไว้

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองเพื่อหาจุดควบแน่นของไอน้ำในอากาศ

อุณหภูมิของอากาศ ในระบบ	ความชื้นของอากาศในระบบ								
	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
30	4.2	7.5	10.2	12.6	15.0	16.5	18.5	20.0	21.5
32	6.1	9.7	12.3	14.5	16.5	18.6	20.2	21.9	23.2
34	7.9	11.0	14.0	16.5	18.2	20.5	22.0	23.8	25.2
36	9.2	12.6	15.5	18.0	20.5	22.2	24.0	25.2	27.0

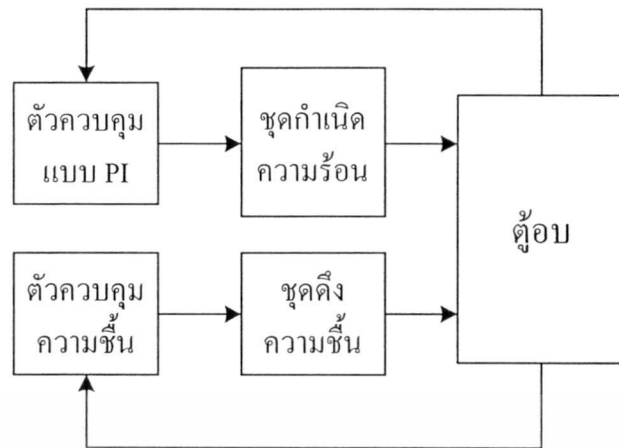
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับทำวิจัยในเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

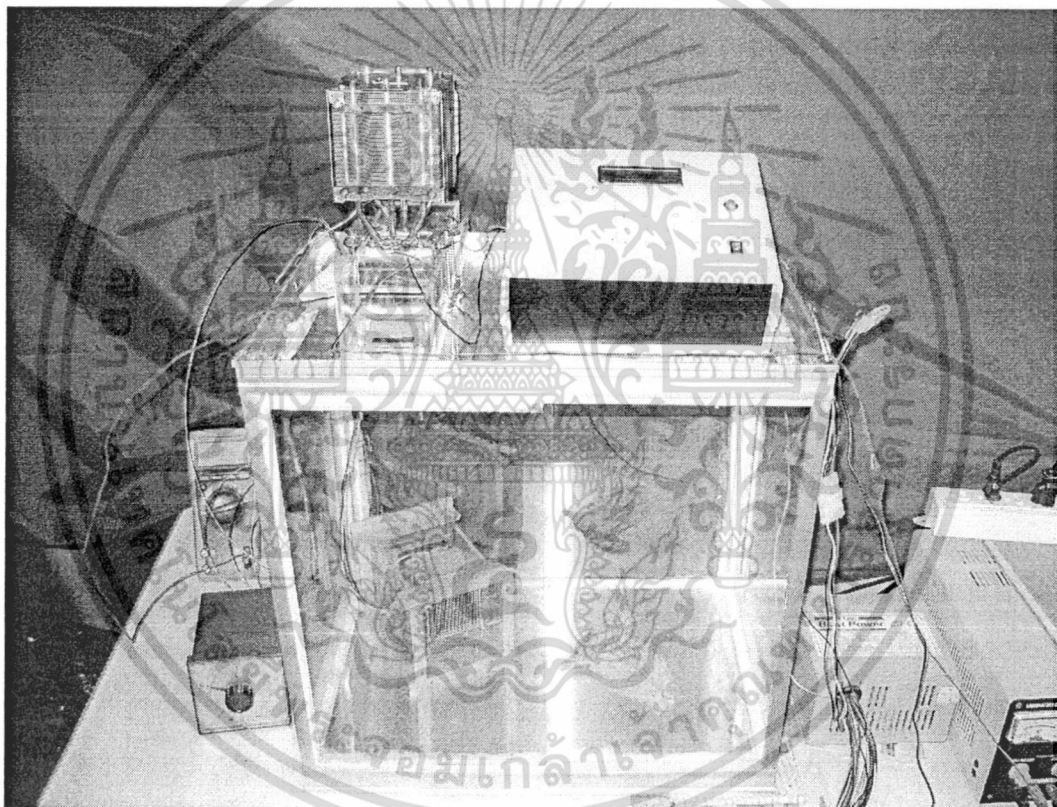
38	11.0	14.5	17.2	19.8	21.8	24.0	25.7	27.4	29.0
40	13.0	16.0	19.0	21.5	23.8	26.0	27.7	29.2	30.5
42	14.2	17.5	20.5	23.2	25.6	27.6	29.2	31.2	32.7
44	16.0	19.5	22.5	25.0	27.2	29.3	31.0	33.0	34.4
46	17.4	21.0	24.2	27.1	29.2	31.2	33.1	34.8	36.4
48	19.0	22.7	25.7	28.6	31.0	33.0	34.9	36.5	38.2
50	20.0	24.7	27.8	30.1	32.5	34.5	36.6	38.3	40.2

จากผลการทดลองในตารางที่ 1 จะได้อุณหภูมิที่แผ่นระบายความร้อนที่ทำให้เกิดจุดควบแน่น ณ ความชื้นและอุณหภูมิก่อนผ่านแผ่นระบบความร้อน ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสมการที่ 1 จะมีความใกล้เคียงกันซึ่งจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างเนื่องมาจากความละเอียดของการแสดงผลอุณหภูมิและความชื้น ต่อจากนั้นออกแบบสร้างตู้อบแห้ง โดยที่ตู้อบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดลองและศึกษาหลักการจะมีขนาดปริมาตรประมาณ 50 ลิตรและติดตั้งระบบสร้างความเย็น โดยใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อใช้ดึงความชื้นไว้ด้านบน โดยมีชุดทำความร้อนเพื่ออุ่นอากาศซึ่งติดตั้งอยู่ด้านในตู้อบ ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ใช้จะเป็นตัวควบคุมแบบ PI สำหรับควบคุมอุณหภูมิให้มีความแม่นยำสูงและมีช่วงการแกว่งน้อย อากาศอุ่นที่สร้างขึ้นนี้จะช่วยในการเร่งการควบแน่นของไอน้ำ อากาศร้อนภายในตู้อบจะลอยตัวสู่ด้านบนพร้อมกับไอน้ำ และถูกดูดด้วยพัดลมดูดอากาศเข้าสู่ระบบสร้างความเย็นโดยใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระบบสร้างความเย็นจะทำการลดอุณหภูมิจนทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำเพื่อดึงความชื้นของอากาศออกมาในรูปของหยดน้ำ และอากาศที่ถูกลดความชื้นจะถูกส่งกลับเข้าไปยังตู้อบ เพื่อให้มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่นำมาอบน้อยที่สุด โดยตัวควบคุมอุณหภูมิจะต่อแยกชุดกับตัววัดค่าและควบคุมความชื้น ส่วนตัวควบคุมความชื้นจะออกแบบให้สามารถควบคุมการลดลงของความชื้นของอากาศให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่รวดเร็วจนทำให้ผิวของผลิตภัณฑ์แห้งจนปิดทางระบายความชื้นในตัวเอง ซึ่งจะเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์แห้งเฉพาะภายนอกและเกิดการเสียหาย ดังนั้นการควบคุมความชื้นภายในตู้อบจะต้องลดลงอย่างช้าๆนั้น ตัวควบคุมจะถูกออกแบบให้แบ่งการควบคุมความชื้นออกเป็นช่วงๆ โดยในโครงการนี้ออกแบบให้ตัวควบคุมสามารถปรับช่วงได้ถึง 10 ช่วง และยังควบคุมพัดลมดูดอากาศที่สามารถควบคุมปริมาณการไหลของอากาศได้ โครงสร้างของการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิภายในตู้อบแสดงในรูปที่ 6 และในรูปที่ 7 แสดงตู้อบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดลองและศึกษาหลักการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6 การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิภายในตู้อบ

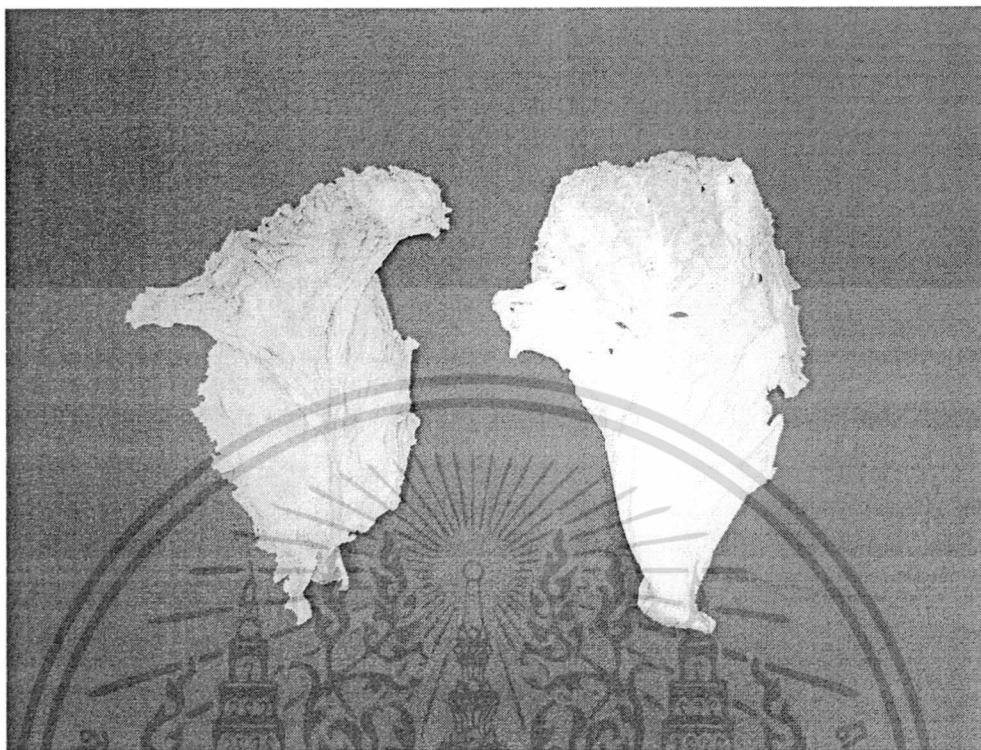


รูปที่ 7 ตู้อบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดลองและศึกษาหลักการ

ผลการทดลอง

จากผลการทดสอบเบื้องต้น โดยการอบแห้งใบผักกาดหอมที่มีคุณสมบัติชื้นง่ายและใบผักกาดขาว เนื่องจากทางโครงการยังไม่มีข้อมูลการอบแห้งใบผักจึงได้เริ่มทำการทดลองอบที่อุณหภูมิ 30°C เพื่อป้องกันใบผักกาดหอมช้ำ จากผลการทดลองจะได้ใบผักกาดหอมและผักกาดขาวที่แห้งโดยใช้เวลาในการอบต่อเนื่องประมาณ 8 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 8 ผลการทดลองอบแห้งใบผักกาดหอมและผักกาดขาว

สรุป

จากการดำเนินการในการทดลองการควบคุมความชื้นภายในตู้อบในเบื้องต้นสามารถควบคุมความชื้นภายในตู้อบได้ดี และความร้อนที่ให้ภายในตู้อบมีอุณหภูมิที่ไม่สูง (น้อยกว่า 50°C) การดำเนินการวิจัยขั้นต่อไปจะเป็นการศึกษาถึงหลักการและวิธีการดึงความชื้นให้ผลิตภัณฑ์มีความแห้งอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถนำมากำหนดวิธีการควบคุมด้วยโปรแกรมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

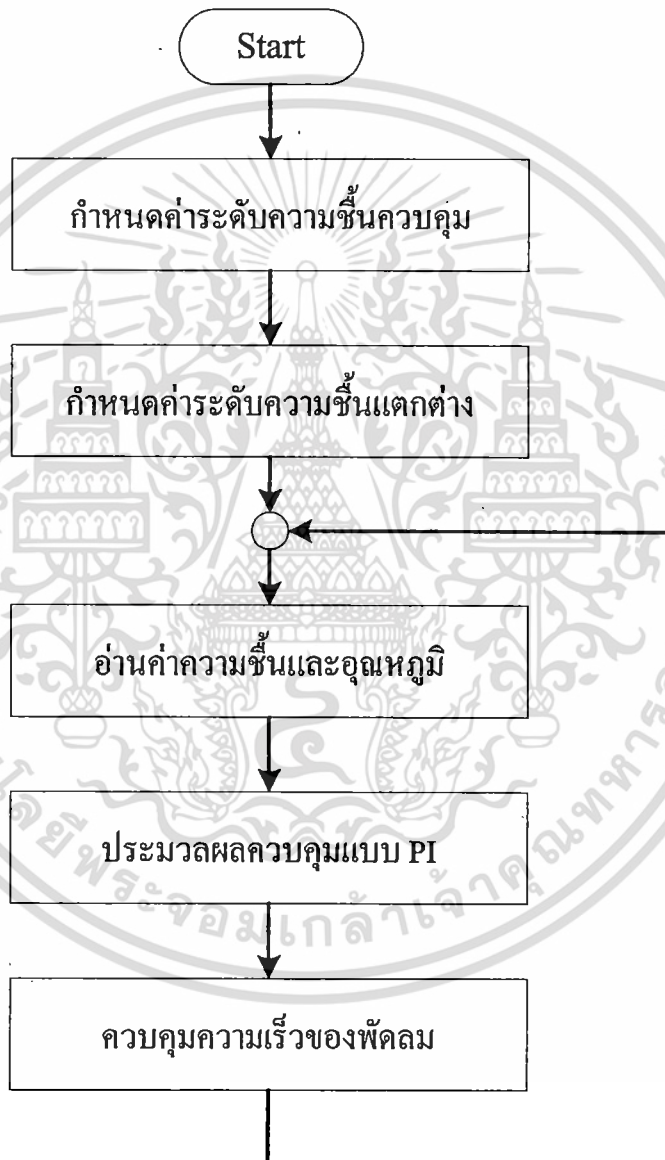
- [1] Prof. Dr. Hajime Tamon, Prof. Dr. Takeshi Furuta, Prof. Dr. Shuji Adachi, Prof. Dr. Shuichi Yamamoto และ ศ. ดร. วิวัฒน์ ตัฒตะพานิชกุล. เทคโนโลยีอบแห้งในอุตสาหกรรมอาหาร, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 2005.
- [2] Microchip Technology Inc., **PIC16F87x data sheet**, printed in the U.S.A. 12/01 , 2001
- [3] ญัตติพล วงศ์สุนทรชัย, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล, **เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F87x**, บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด



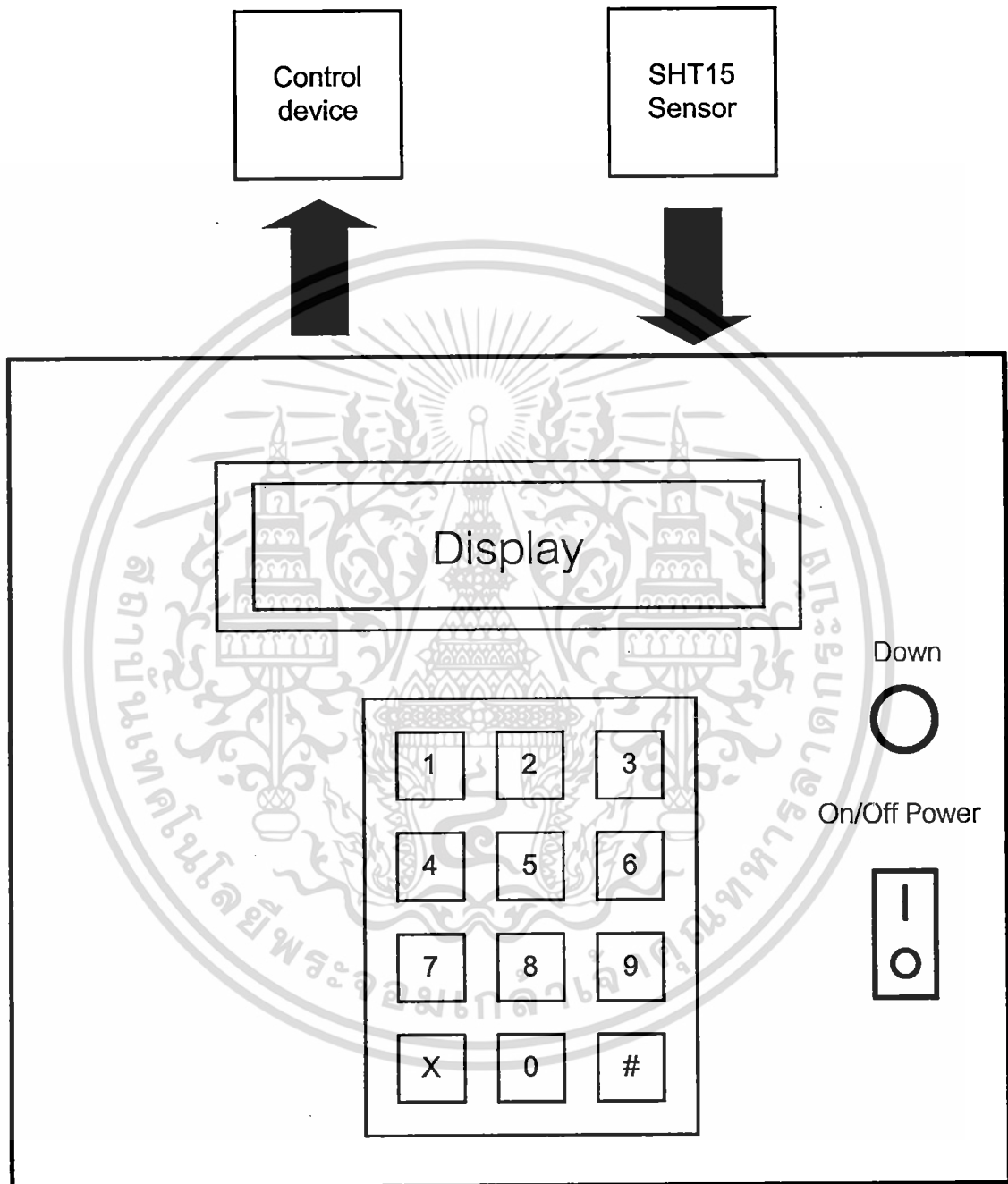
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก.
เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

ก. 1 โฟลว์ชาร์ตการทำงานของเครื่อง



ก.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง



ขั้นตอนการตั้งค่าระดับความชื้นควบคุม (Set Point Humid)

กดปุ่ม * 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าระดับความชื้นควบคุมภายในตู้อบ จอ LCD จะแสดง

Set Point Humid
SP = xx %RH

โดยที่ xx คือค่าระดับความชื้นภายในตู้อบที่จะควบคุม ทำการกำหนดค่าความชื้นโดยการกดเป็นตัวเลขจำนวน 2 หลัก ตั้งแต่ 00 ถึง 99 การกดตัวเลขครั้งแรกจะเป็นการกำหนดหลักสิบ และกดตัวเลขตัวต่อไปจะเป็นหลักหน่วย

กดปุ่ม * อีก 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าระดับความชื้นควบคุมภายในตู้อบ จอ LCD จะแสดง

Set Point Offset
Offset = -x %RH

โดยที่ x คือค่าปรับระดับความชื้นภายในตู้อบที่ควบคุมแบบ PI ซึ่งจะเป็นค่าที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น พัดลม และตัวทำความร้อน ทำการกำหนดค่าโดยการกดเป็นตัวเลขจำนวน 1 หลัก ตั้งแต่ 0 ถึง 9

หลังจากนั้นกดปุ่ม # เพื่อทำการบันทึกค่าต่างๆ และออกจากเมนูกำหนดค่านี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุม โดยหน้าต่างในขณะที่ทำการควบคุมจะแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิของตู้อบดังนี้

Humid = xxx %RH
Temp. = xxx.x °C

ก.3 โปรแกรม

** Start up code	001F: MOVF 23,W	0096: GOTO 094	015A: MOVLW 10
0000: MOVLW 08	0020: MOVWF @77	0097: DECFSZ @78,F	015B: MOVWF @77
0001: MOVWF PCLATH	0021: MOVF 24,W	0098: GOTO 092	015C: DECFSZ @77,F
0002: GOTO main	0022: MOVWF @78	0099: MOVLW 3C	015D: GOTO 15C
0003: NOP	0023: MOVF 25,W	009A: MOVWF @77	015E: BCF PORTB.6
0004: MOVWF ADCON0	0024: MOVWF @79	009B: DECFSZ @77,F	015F: RETLW 00
0005: SWAPF STATUS,W	0025: MOVF 26,W	009C: GOTO 09B	0160: BCF PORTB.1
0006: CLRF STATUS	0026: MOVWF @7A	009D: NOP	0161: CLRWDT
0007: MOVWF 21	0027: MOVF 27,W	009E: CLRWDT	0162: MOVLW 07
0008: MOVF PCLATH,W	0028: MOVWF @7B	009F: DECFSZ INDF,F	0163: MOVWF @77
0009: MOVWF 20	0029: MOVF 20,W	00A0: GOTO 090	0164: DECFSZ @77,F
000A: CLRF PCLATH	002A: MOVWF PCLATH	00A1: RETLW 00	0165: GOTO 164
000B: MOVF FSR,W	002B: SWAPF 21,W	** LCD Module	0166: NOP
000C: MOVWF 22	002C: MOVWF STATUS	0147: MOVF n,W	0167: NOP
000D: MOVF @77,W	002D: SWAPF ADCON0,F	0148: ANDLW 0F	0168: BTFSS address.0
000E: MOVWF 23	002E: SWAPF ADCON0,W	0149: MOVWF @77	0169: BCF PORTB.1
000F: MOVF @78,W	002F: RETFIE	014A: BCF STATUS.0	016A: BTFSC address.0
0010: MOVWF 24	0030: BCF PCLATH.3	014B: RLF @77,F	016B: BSF PORTB.1
0011: MOVF @79,W	0031: BCF PCLATH.4	014C: RLF @77,F	016C: CLRWDT
0012: MOVWF 25	0032: GOTO 074	014D: MOVLW C3	016D: MOVLW 10
0013: MOVF @7A,W	008A: MOVLW ??65535	014E: ANDWF PORTB,W	016E: MOVWF @77
0014: MOVWF 26	008B: MOVWF FSR	014F: IORWF @77,W	016F: DECFSZ @77,F
0015: MOVF @7B,W	008C: BCF STATUS.7	0150: MOVWF PORTB	0170: GOTO 16F
0016: MOVWF 27	008D: MOVF INDF,W	0151: CLRWDT	0171: BCF PORTB.6
0017: BCF STATUS.7	008E: BTFSC STATUS.2	0152: MOVLW 07	0172: SWAPF n,W
0018: BCF STATUS.5	008F: GOTO 0A1	0153: MOVWF @77	0173: MOVWF @@6D
0019: BTFSS INTCON.5	0090: MOVLW 03	0154: DECFSZ @77,F	0174: MOVLW 0F
001A: GOTO 01D	0091: MOVWF @78	0155: GOTO 154	0175: ANDWF @@6D,F
001B: BTFSC INTCON.2	0092: MOVLW BF	0156: NOP	0176: MOVF @@6D,W
001C: GOTO 030	0093: MOVWF @77	0157: NOP	0177: MOVWF n
001D: MOVF 22,W	0094: CLRWDT	0158: BSF PORTB.6	0178: CALL
001E: MOVWF FSR	0095: DECFSZ @77,F	0159: CLRWDT	0179: MOVF n,W

017A: ANDLW 0F	019B: MOVWF n	01D4: CLRF address	01DB: MOVWF n
017B: MOVWF @@6D	019C: CALL	01D5: MOVF @@6A,W	01DC: CALL
017C: MOVWF n	lcd_send_nibble	01D6: MOVWF n	lcd_send_byte
017D: CALL	019D: CLRF i	01D7: CALL	01DD: GOTO 1E4
017E: RETLW 00	019E: MOVF i,W	lcd_send_byte	01DE: MOVLW 01
017F: MOVLW 01	019F: SUBLW 03	01AE: MOVF c,W	01DF: MOVWF address
0180: BSF STATUS.5	01A0: BTFSS STATUS.0	01AF: XORLW 0C	01E0: MOVF c,W
0181: MOVWF TRISB	01A1: GOTO 1AB	01B0: BTFSC STATUS.2	01E1: MOVWF n
0182: BCF STATUS.5	01A2: MOVF i,W	01B1: GOTO 1B9	01E2: CALL
0183: BCF PORTB.1	01A3: CALL @const39	01B2: XORLW 06	lcd_send_byte
0184: BCF PORTB.6	01A4: MOVWF @@60	01B3: BTFSC STATUS.2	01E3: GOTO 1E4
0185: MOVLW 0F	01A5: CLRF address	01B4: GOTO 1C3	01E4: RETLW 00
0186: BSF STATUS.5	01A6: MOVF @@60,W	01B5: XORLW 02	** SHT15 Module
0187: MOVWF ??65535	01A7: MOVWF n	01B6: BTFSC STATUS.2	00D3: BSF STATUS.5
0188: BCF STATUS.5	01A8: CALL	01B7: GOTO 1D9	00D4: CLRF error
0189: CALL @delay_ms1	lcd_send_byte	01B8: GOTO 1DE	00D5: MOVLW 80
018A: MOVLW 01	01A9: INCF i,F	01B9: CLRF address	00D6: MOVWF i
018B: MOVWF i	01AA: GOTO 19E	01BA: MOVLW 01	00D7: MOVF i,F
018C: MOVF i,W	01AB: BSF PCLATH.3	01BB: MOVWF n	00D8: BTFSC STATUS.2
018D: SUBLW 03	01AC: BCF PCLATH.4	01BC: CALL	00D9: GOTO 0F2
018E: BTFSS STATUS.0	01AD: GOTO 399	lcd_send_byte	00DA: MOVF i,W
018F: GOTO 19A	01C7: DECFSZ y,W	01BD: MOVLW 02	00DB: ANDWF data_in,W
0190: MOVLW 03	01C8: GOTO 1CA	01BE: BSF STATUS.5	00DC: XORLW 00
0191: MOVWF n	01C9: GOTO 1CD	01BF: MOVWF ??65535	00DD: BTFSC STATUS.2
0192: CALL	01CA: MOVLW 40	01C0: BCF STATUS.5	00DE: GOTO 0E4
lcd_send_nibble	01CB: MOVWF address	01C1: CALL @delay_ms1	00DF: BCF TRISA.5
0193: MOVLW 05	01CC: GOTO 1CE	01C2: GOTO 1E4	00E0: BCF STATUS.5
0194: BSF STATUS.5	01CD: CLRF address	01C3: MOVLW 01	00E1: BSF PORTA.5
0195: MOVWF ??65535	01CE: MOVLW 01	01C4: MOVWF x	00E2: GOTO 0E7
0196: BCF STATUS.5	01CF: SUBWF x,W	01C5: MOVLW 02	00E3: BSF STATUS.5
0197: CALL @delay_ms1	01D0: ADDWF address,F	01C6: MOVWF y	00E4: BCF TRISA.5
0198: INCF i,F	01D1: MOVF address,W	01D8: GOTO 1E4	00E5: BCF STATUS.5
0199: GOTO 18C	01D2: IORLW 80	01D9: CLRF address	00E6: BCF PORTA.5
019A: MOVLW 02	01D3: MOVWF @@6A	01DA: MOVLW 10	00E7: BSF PORTA.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 15

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

00E8: CLRWDT	0201: MOVLW 80	0223: BCF PORTA.5	00AE: NOP
00E9: NOP	0202: BSF STATUS.5	0224: BSF PORTA.4	00AF: NOP
00EA: NOP	0203: MOVWF i	0225: CLRWDT	00B0: NOP
00EB: NOP	0204: MOVF i,F	0226: NOP	00B1: NOP
00EC: NOP	0205: BTFSC STATUS.2	0227: NOP	00B2: BSF STATUS.5
00ED: BCF PORTA.4	0206: GOTO 221	0228: NOP	00B3: BCF TRISA.5
00EE: BCF STATUS.0	0207: BCF STATUS.5	0229: NOP	00B4: BCF STATUS.5
00EF: BSF STATUS.5	0208: BSF PORTA.4	022A: BCF PORTA.4	00B5: BCF PORTA.5
00F0: RRF i,F	0209: CLRWDT	022B: CLRWDT	00B6: CLRWDT
00F1: GOTO 0D7	020A: NOP	022C: NOP	00B7: NOP
00F2: BCF TRISA.5	020B: NOP	022D: NOP	00B8: NOP
00F3: BCF STATUS.5	020C: NOP	022E: NOP	00B9: NOP
00F4: BSF PORTA.5	020D: NOP	022F: NOP	00BA: NOP
00F5: BSF PORTA.4	020E: BSF STATUS.5	0230: BSF STATUS.5	00BB: BCF PORTA.4
00F6: BSF STATUS.5	020F: BSF TRISA.5	0231: BCF TRISA.5	00BC: CLRWDT
00F7: BSF TRISA.5	0210: BCF STATUS.5	0232: BCF STATUS.5	00BD: MOVLW 03
00F8: CLRF error	0211: BTFSS PORTA.5	0233: BSF PORTA.5	00BE: MOVWF @77
00F9: BCF STATUS.5	0212: GOTO 217	0234: BSF STATUS.5	00BF: DECFSZ @77,F
00FA: BTFSS PORTA.5	0213: BSF STATUS.5	0235: MOVF val,W	00C0: GOTO 0BF
00FB: GOTO 0FF	0214: MOVF i,W	0236: MOVWF @78	00C1: NOP
00FC: BSF STATUS.5	0215: IORWF val,F	0237: BCF STATUS.5	00C2: BSF PORTA.4
00FD: INCF error,F	0216: BCF STATUS.5	0238: RETLW 00	00C3: CLRWDT
00FE: BCF STATUS.5	0217: BCF PORTA.4	00A2: BSF STATUS.5	00C4: NOP
00FF: BCF PORTA.4	0218: CLRWDT	00A3: BCF TRISA.5	00C5: NOP
0100: BSF STATUS.5	0219: NOP	00A4: BCF STATUS.5	00C6: NOP
0101: MOVF error,W	021A: NOP	00A5: BSF PORTA.5	00C7: NOP
0102: MOVWF @78	021B: NOP	00A6: BCF PORTA.4	00C8: BSF STATUS.5
0103: BCF STATUS.5	021C: NOP	00A7: CLRWDT	00C9: BCF TRISA.5
0104: RETLW 00	021D: BCF STATUS.0	00A8: NOP	00CA: BCF STATUS.5
01FC: BSF STATUS.5	021E: BSF STATUS.5	00A9: NOP	00CB: BSF PORTA.5
01FD: CLRF val	021F: RRF i,F	00AA: NOP	00CC: CLRWDT
01FE: BCF TRISA.5	0220: GOTO 204	00AB: NOP	00CD: NOP
01FF: BCF STATUS.5	0221: BCF TRISA.5	00AC: BSF PORTA.4	00CE: NOP
0200: BSF PORTA.5	0222: BCF STATUS.5	00AD: CLRWDT	00CF: NOP

00D0: NOP	0124: MOVLW 1E	0451: SUBLW E7	0473: GOTO 44A
00D1: BCF PORTA.4	0125: BSF STATUS.5	0452: BTFSS STATUS.0	0474: BSF TRISA.5
00D2: RETLW 00	0126: MOVWF data_in	0453: GOTO 474	0475: MOVLW 00
0107: BCF TRISA.5	0127: BCF STATUS.5	0454: BTFSC 20.0	0476: BCF STATUS.5
0108: BCF STATUS.5	0128: CALL write_SHT11	0455: GOTO 474	0477: BTFSC PORTA.5
0109: BSF PORTA.5	0129: MOVF @78,W	0456: BSF TRISA.5	0478: MOVLW 01
010A: BCF PORTA.4	012A: BSF STATUS.5	0457: MOVLW 00	0479: SUBLW 01
010B: BSF STATUS.5	012B: ADDWF error,F	0458: BCF STATUS.5	047A: BTFSS STATUS.2
010C: CLRF i	012C: MOVF error,W	0459: BTFSC PORTA.5	047B: GOTO 480
010D: MOVF i,W	012D: MOVWF @78	045A: MOVLW 01	047C: MOVLW 01
010E: SUBLW 08	012E: BCF STATUS.5	045B: XORLW 00	047D: BSF STATUS.5
010F: BTFSS STATUS.0	012F: RETLW 00	045C: BTFSS STATUS.2	047E: ADDWF error,F
0110: GOTO 11C	043B: BSF STATUS.5	045D: GOTO 46F	047F: BCF STATUS.5
0111: BCF STATUS.5	043C: CLRF error	045E: CLRWDT	0480: MOVLW 01
0112: BSF PORTA.4	043D: BCF STATUS.5	045F: NOP	0481: BSF STATUS.5
0113: CLRWDT	043E: CALL s_transstart	0460: NOP	0482: MOVWF ??65535
0114: NOP	043F: MOVLW 05	0461: NOP	0483: BCF STATUS.5
0115: NOP	0440: BSF STATUS.5	0462: NOP	0484: CALL read_SHT11
0116: NOP	0441: MOVWF data_in	0463: BSF STATUS.5	0485: MOVF @78,W
0117: NOP	0442: BCF STATUS.5	0464: BSF TRISA.5	0486: BSF STATUS.5
0118: BCF PORTA.4	0443: CALL write_SHT11	0465: MOVLW 00	0487: MOVWF tmp1
0119: BSF STATUS.5	0444: MOVF @78,W	0466: BCF STATUS.5	0488: MOVLW 01
011A: INCF i,F	0445: BSF STATUS.5	0467: BTFSC PORTA.5	0489: MOVWF ??65535
011B: GOTO 10D	0446: ADDWF error,F	0468: MOVLW 01	048A: BCF STATUS.5
011C: BCF STATUS.5	0447: CLRF i+1	0469: XORLW 00	048B: CALL read_SHT11
011D: CALL s_transstart	0448: CLRF i	046A: BTFSS STATUS.2	048C: MOVF @78,W
0105: BSF STATUS.5	0449: BCF exit	046B: GOTO 46F	048D: BSF STATUS.5
0106: CLRF error	044A: MOVF i+1,W	046C: BSF STATUS.5	048E: MOVWF tmp2
011E: MOVLW 64	044B: SUBLW FD	046D: BSF exit	048F: CLRF ??65535
011F: BSF STATUS.5	044C: BTFSS STATUS.0	046E: BCF STATUS.5	0490: BCF STATUS.5
0120: MOVWF ??65535	044D: GOTO 474	046F: BSF STATUS.5	0491: CALL read_SHT11
0121: BCF STATUS.5	044E: BTFSS STATUS.2	0470: INCF 25,F	0492: MOVF @78,W
0122: CALL @delay_ms1	044F: GOTO 454	0471: BTFSC STATUS.2	0493: MOVWF checksum
0123: CALL s_transstart	0450: MOVF i,W	0472: INCF i+1,F	0494: CLRF

humi_val_l+1	04B4: CLRF i+1	04D6: XORLW 00	04F8: CALL read_SHT11
0495: BSF STATUS.5	04B5: CLRF i	04D7: BTFSS STATUS.2	04F9: MOVF @78,W
0496: MOVF tmp1,W	04B6: BCF exit	04D8: GOTO 4DC	04FA: BSF STATUS.5
0497: BCF STATUS.5	04B7: MOVF i+1,W	04D9: BSF STATUS.5	04FB: MOVWF tmp2
0498: MOVWF	04B8: SUBLW FD	04DA: BSF exit	04FC: CLRF ??65535
humi_val_l	04B9: BTFSS STATUS.0	04DB: BCF STATUS.5	04FD: BCF STATUS.5
0499: MOVF	04BA: GOTO 4E1	04DC: BSF STATUS.5	04FE: CALL read_SHT11
humi_val_l,W	04BB: BTFSS STATUS.2	04DD: INCF 25,F	04FF: MOVF @78,W
049A: MOVWF	04BC: GOTO 4C1	04DE: BTFSC STATUS.2	0500: MOVWF checksum
humi_val_l+1	04BD: MOVF i,W	04DF: INCF i+1,F	0501: CLRF temp_val_l+1
049B: CLRF humi_val_l	04BE: SUBLW E7	04E0: GOTO 4B7	0502: BSF STATUS.5
049C: BSF STATUS.5	04BF: BTFSS STATUS.0	04E1: BSF TRISA.5	0503: MOVF tmp1,W
049D: MOVF tmp2,W	04C0: GOTO 4E1	04E2: MOVLW 00	0504: BCF STATUS.5
049E: MOVWF tmp_l	04C1: BTFSC 20.0	04E3: BCF STATUS.5	0505: MOVWF temp_val_l
049F: MOVF tmp_l,W	04C2: GOTO 4E1	04E4: BTFSC PORTA.5	0506: MOVF
04A0: BCF STATUS.5	04C3: BSF TRISA.5	04E5: MOVLW 01	temp_val_l,W
04A1: IORWF	04C4: MOVLW 00	04E6: SUBLW 01	0507: MOVWF
humi_val_l,F	04C5: BCF STATUS.5	04E7: BTFSS STATUS.2	temp_val_l+1
04A2: BSF STATUS.5	04C6: BTFSC PORTA.5	04E8: GOTO 4ED	0508: CLRF temp_val_l
04A3: MOVF error,W	04C7: MOVLW 01	04E9: MOVLW 01	0509: BSF STATUS.5
04A4: MOVWF @78	04C8: XORLW 00	04EA: BSF STATUS.5	050A: MOVF tmp2,W
04A8: BSF STATUS.5	04C9: BTFSS STATUS.2	04EB: ADDWF error,F	050B: MOVWF tmp_l
04A9: CLRF error	04CA: GOTO 4DC	04EC: BCF STATUS.5	050C: MOVF tmp_l,W
04AA: BCF STATUS.5	04CB: CLRWDT	04ED: MOVLW 01	050D: BCF STATUS.5
04AB: CALL s_transstart	04CC: NOP	04EE: BSF STATUS.5	050E: IORWF
04AC: MOVLW 03	04CD: NOP	04EF: MOVWF ??65535	temp_val_l,F
04AD: BSF STATUS.5	04CE: NOP	04F0: BCF STATUS.5	050F: BSF STATUS.5
04AE: MOVWF data_in	04CF: NOP	04F1: CALL read_SHT11	0510: MOVF error,W
04AF: BCF STATUS.5	04D0: BSF STATUS.5	04F2: MOVF @78,W	0511: MOVWF @78
04B0: CALL	04D1: BSF TRISA.5	04F3: BSF STATUS.5	0130: BSF STATUS.5
write_SHT11	04D2: MOVLW 00	04F4: MOVWF tmp1	0131: CLRF error
04B1: MOVF @78,W	04D3: BCF STATUS.5	04F5: MOVLW 01	0132: BCF STATUS.5
04B2: BSF STATUS.5	04D4: BTFSC PORTA.5	04F6: MOVWF ??65535	0133: CALL s_transstart
04B3: ADDWF error,F	04D5: MOVLW 01	04F7: BCF STATUS.5	0134: MOVLW 06

0135: BSF STATUS.5	01F2: IORLW 00	06BF: MOVWF	06D8: CALL @MUL1616
0136: MOVWF data_in	01F3: BTFSC STATUS.2	data_lcd+8	06D9: MOVF @78,W
0137: BCF STATUS.5	01F4: GOTO 1F9	06C0: CLRF tmp3+1	06DA: SUBWF tmp3,F
0138: CALL write_SHT11	01F5: INCF @@5F,F	06C1: MOVF	06DB: MOVF @79,W
0139: MOVF @78,W	01F6: MOVWF c	percent_RH,W	06DC: BTFSS STATUS.0
013A: BSF STATUS.5	01F7: CALL lcd_putc	06C2: MOVWF tmp3	06DD: INCFSZ @79,W
013B: ADDWF error,F	01F8: GOTO 1F0	06C3: MOVF tmp3+1,W	06DE: SUBWF tmp3+1,F
013C: MOVF value,W	01F9: BSF PCLATH.3	06C4: MOVWF	06DF: MOVF tmp3,W
013D: MOVWF data_in	01FA: BCF PCLATH.4	??65535+1	06E0: MOVWF tmp1
013E: BCF STATUS.5	01FB: GOTO 39C	06C5: MOVF tmp3,W	06E1: MOVF tmp1,W
013F: CALL write_SHT11	06AE: MOVLW 20	06C6: MOVWF ??65535	06E2: MOVWF ??65535
0140: MOVF @78,W	06AF: MOVWF data_lcd	06C7: CLRF	06E3: MOVLW 0A
0141: BSF STATUS.5	06B0: MOVLW 48	@DIV1616.P1+1	06E4: MOVWF
0142: ADDWF error,F	06B1: MOVWF	06C8: MOVLW 64	@DIV88.P1
0143: MOVF error,W	data_lcd+1	06C9: MOVWF	06E5: CALL @DIV88
0144: MOVWF @78	06B2: MOVLW 75	@DIV1616.P1	06E6: MOVF @78,W
0145: BCF STATUS.5	06B3: MOVWF	06CA: CALL @DIV1616	06E7: MOVWF
0146: RETLW 00	data_lcd+2	06CB: MOVF @79,W	data_lcd+10
** Main	06B4: MOVLW 6D	06CC: MOVWF tmp2+1	06E8: MOVF tmp1,W
01E5: CLRF @@5F	06B5: MOVWF	06CD: MOVF @78,W	06E9: MOVWF ??65535
01E6: MOVF @@5F,W	data_lcd+3	06CE: MOVWF tmp2	06EA: MOVLW 0A
01E7: CALL	06B6: MOVLW 69	06CF: MOVF tmp2,W	06EB: MOVWF
@const10195	06B7: MOVWF	06D0: MOVWF	@DIV88.P1
01E8: IORLW 00	data_lcd+4	data_lcd+9	06EC: CALL @DIV88
01E9: BTFSC STATUS.2	06B8: MOVLW 64	06D1: MOVF tmp2+1,W	06ED: MOVF @77,W
01EA: GOTO 1EF	06B9: MOVWF	06D2: MOVWF	06EE: MOVWF
01EB: INCF @@5F,F	data_lcd+5	??65535+1	data_lcd+11
01EC: MOVWF c	06BA: MOVLW 20	06D3: MOVF tmp2,W	06EF: MOVLW 30
01ED: CALL lcd_putc	06BB: MOVWF	06D4: MOVWF ??65535	06F0: ADDWF
01EE: GOTO 1E6	data_lcd+6	06D5: CLRF	data_lcd+9,F
01EF: CLRF @@5F	06BC: MOVLW 3D	@MUL1616.P1+1	06F1: ADDWF
01F0: MOVF @@5F,W	06BD: MOVWF	06D6: MOVLW 64	data_lcd+10,F
01F1: CALL	data_lcd+7	06D7: MOVWF	06F2: ADDWF
@const10200	06BE: MOVLW 20	@MUL1616.P1	data_lcd+11,F

06F3: MOVLW 25	0709: MOVLW 20	@MUL1616.P1	??65535+1
06F4: MOVWF	070A: MOVWF	0722: CALL @MUL1616	073C: MOVF tmp2,W
data_lcd+12	data_lcd+24	0723: MOVF @78,W	073D: MOVWF ??65535
06F5: MOVLW 52	070B: MOVF	0724: SUBWF	073E: CLRF
06F6: MOVWF	temperature+1,W	temperature,W	@MUL1616.P1+1
data_lcd+13	070C: MOVWF	0725: MOVWF tmp3	073F: MOVLW 64
06F7: MOVLW 48	??65535+1	0726: MOVF	0740: MOVWF
06F8: MOVWF	070D: MOVF	temperature+1,W	@MUL1616.P1
data_lcd+14	temperature,W	0727: MOVWF 64	0741: CALL @MUL1616
06F9: MOVLW 20	070E: MOVWF ??65535	0728: MOVF @79,W	0742: MOVF @78,W
06FA: MOVWF	070F: MOVLW 03	0729: BTSS STATUS.0	0743: SUBWF tmp3,F
data_lcd+15	0710: MOVWF	072A: INCFSZ @79,W	0744: MOVF @79,W
06FB: MOVWF	@DIV1616.P1+1	072B: SUBWF	0745: BTSS STATUS.0
data_lcd+16	0711: MOVLW E8	temperature+10,F	0746: INCFSZ @79,W
06FC: MOVLW 54	0712: MOVWF	072C: MOVF tmp3+1,W	0747: SUBWF tmp3+1,F
06FD: MOVWF	@DIV1616.P1	072D: MOVWF	0748: MOVF tmp3,W
data_lcd+17	0713: CALL @DIV1616	??65535+1	0749: MOVWF tmp1
06FE: MOVLW 65	0714: MOVF @79,W	072E: MOVF tmp3,W	074A: MOVF tmp1,W
06FF: MOVWF	0715: MOVWF tmp2+1	072F: MOVWF ??65535	074B: MOVWF ??65535
data_lcd+18	0716: MOVF @78,W	0730: CLRF	074C: MOVLW 0A
0700: MOVLW 6D	0717: MOVWF tmp2	@DIV1616.P1+1	074D: MOVWF
0701: MOVWF	0718: MOVF tmp2,W	0731: MOVLW 64	@DIV88.P1
data_lcd+19	0719: MOVWF	0732: MOVWF	074E: CALL @DIV88
0702: MOVLW 70	data_lcd+25	@DIV1616.P1	074F: MOVF @78,W
0703: MOVWF	071A: MOVF tmp2+1,W	0733: CALL @DIV1616	0750: MOVWF
data_lcd+20	071B: MOVWF	0734: MOVF @79,W	data_lcd+27
0704: MOVLW 20	??65535+1	0735: MOVWF tmp2+1	0751: MOVF tmp1,W
0705: MOVWF	071C: MOVF tmp2,W	0736: MOVF @78,W	0752: MOVWF ??65535
data_lcd+21	071D: MOVWF ??65535	0737: MOVWF tmp2	0753: MOVLW 0A
0706: MOVWF	071E: MOVLW 03	0738: MOVF tmp2,W	0754: MOVWF
data_lcd+22	071F: MOVWF	0739: MOVWF	@DIV88.P1
0707: MOVLW 3D	@MUL1616.P1+1	data_lcd+26	0755: CALL @DIV88
0708: MOVWF	0720: MOVLW E8	073A: MOVF tmp2+1,W	0756: MOVF @77,W
data_lcd+23	0721: MOVWF	073B: MOVWF	0757: MOVWF

data_lcd+29	0771: BTFSS STATUS.0	0792: MOVWF @@65	081A: MOVLW 75
0758: MOVLW 30	0772: GOTO 77D	0793: MOVWF c	081B: MOVWF 3A
0759: ADDWF	0773: MOVLW data_lcd	0794: CALL lcd_putc	081C: MOVLW 6D
data_lcd+25,F	0774: ADDWF i,W	0795: INCF i,F	081D: MOVWF 3B
075A: ADDWF	0775: MOVWF FSR	0796: GOTO 789	081E: MOVLW 69
data_lcd+26,F	0776: BCF STATUS.7	0797: BSF PCLATH.3	081F: MOVWF 3C
075B: ADDWF	0777: MOVF INDF,W	0798: BCF PCLATH.4	0820: MOVLW 64
data_lcd+27,F	0778: MOVWF @@65	0799: GOTO 3D6	0821: MOVWF 3D
075C: MOVLW 2E	0779: MOVWF c	0800: MOVF 57,W	0822: MOVLW 20
075D: MOVWF	077A: CALL lcd_putc	0801: SUBLW 02	0823: MOVWF 3E
data_lcd+28	077B: INCF i,F	0802: BTFSS STATUS.0	0824: MOVLW 53
075E: MOVLW 30	077C: GOTO 76F	0803: GOTO 044	0825: MOVWF 3F
075F: ADDWF	077D: CLRF @@65	0804: MOVLW 53	0826: MOVLW 50
data_lcd+29,F	077E: MOVF @@65,W	0805: MOVWF 2F	0827: MOVWF 40
0760: MOVLW 27	077F: CALL	0806: MOVLW 65	0828: MOVLW 20
0761: MOVWF	@const10244	0807: MOVWF 30	0829: MOVWF 41
data_lcd+30	0780: IORLW 00	0808: MOVLW 74	082A: MOVLW 3D
0762: MOVLW 43	0781: BTFSC STATUS.2	0809: MOVWF 31	082B: MOVWF 42
0763: MOVWF	0782: GOTO 787	080A: MOVLW 20	082C: MOVLW 20
data_lcd+31	0783: INCF @@65,F	080B: MOVWF 32	082D: MOVWF 43
0764: CLRF @@65	0784: MOVWF c	080C: MOVLW 50	082E: MOVWF 44
0765: MOVF @@65,W	0785: CALL lcd_putc	080D: MOVWF 33	082F: MOVWF 45
0766: CALL	0786: GOTO 77E	080E: MOVLW 6F	0830: MOVWF 46
@const10231	0787: MOVLW 10	080F: MOVWF 34	0831: MOVWF 47
0767: IORLW 00	0788: MOVWF i	0810: MOVLW 69	0832: MOVF 55,W
0768: BTFSC STATUS.2	0789: MOVF i,W	0811: MOVWF 35	0833: MOVWF 48
0769: GOTO 76E	078A: SUBLW 1F	0812: MOVLW 6E	0834: MOVF 56,W
076A: INCF @@65,F	078B: BTFSS STATUS.0	0813: MOVWF 36	0835: MOVWF 49
076B: MOVWF c	078C: GOTO 797	0814: MOVLW 74	0836: MOVLW 30
076C: CALL lcd_putc	078D: MOVLW data_lcd	0815: MOVWF 37	0837: ADDWF 48,F
076D: GOTO 765	078E: ADDWF i,W	0816: MOVLW 20	0838: ADDWF 49,F
076E: CLRF i	078F: MOVWF FSR	0817: MOVWF 38	0839: MOVLW 20
076F: MOVF i,W	0790: BCF STATUS.7	0818: MOVLW 48	083A: MOVWF 4A
0770: SUBLW 0F	0791: MOVF INDF,W	0819: MOVWF 39	083B: MOVLW 25

083C: MOVWF 4B	085E: MOVWF 3C	0880: MOVLW 48	08A1: INCF 5F,F
083D: MOVLW 52	085F: MOVLW 65	0881: MOVWF 4D	08A2: GOTO 093
083E: MOVWF 4C	0860: MOVWF 3D	0882: MOVLW 20	08A3: CLRF 61
083F: MOVLW 48	0861: MOVLW 74	0883: MOVWF 4E	08A4: MOVF 61,W
0840: MOVWF 4D	0862: MOVWF 3E	0884: CLRF 61	08A5: BCF PCLATH.3
0841: MOVLW 20	0863: MOVLW 4F	0885: MOVF 61,W	08A6: CALL
0842: MOVWF 4E	0864: MOVWF 3F	0886: BCF PCLATH.3	@const10244
0843: GOTO 084	0865: MOVLW 66	0887: CALL	08A7: BSF PCLATH.3
0844: MOVLW 53	0866: MOVWF 40	@const10231	08A8: IORLW 00
0845: MOVWF 2F	0867: MOVWF 41	0888: BSF PCLATH.3	08A9: BTFSC STATUS.2
0846: MOVLW 65	0868: MOVLW 73	0889: IORLW 00	08AA: GOTO 0B1
0847: MOVWF 30	0869: MOVWF 42	088A: BTFSC STATUS.2	08AB: INCF 61,F
0848: MOVLW 74	086A: MOVLW 65	088B: GOTO 092	08AC: MOVWF c
0849: MOVWF 31	086B: MOVWF 43	088C: INCF 61,F	08AD: BCF PCLATH.3
084A: MOVLW 20	086C: MOVLW 74	088D: MOVWF c	08AE: CALL lcd_putc
084B: MOVWF 32	086D: MOVWF 44	088E: BCF PCLATH.3	08AF: BSF PCLATH.3
084C: MOVLW 50	086E: MOVLW 20	088F: CALL lcd_putc	08B0: GOTO 0A4
084D: MOVWF 33	086F: MOVWF 45	0890: BSF PCLATH.3	08B1: MOVLW 10
084E: MOVLW 6F	0870: MOVLW 3D	0891: GOTO 085	08B2: MOVWF 5F
084F: MOVWF 34	0871: MOVWF 46	0892: CLRF 5F	08B3: MOVF 5F,W
0850: MOVLW 69	0872: MOVLW 20	0893: MOVF 5F,W	08B4: SUBLW 1F
0851: MOVWF 35	0873: MOVWF 47	0894: SUBLW 0F	08B5: BTFSS STATUS.0
0852: MOVLW 6E	0874: MOVLW 2D	0895: BTFSS STATUS.0	08B6: GOTO 0C3
0853: MOVWF 36	0875: MOVWF 48	0896: GOTO 0A3	08B7: MOVLW 2F
0854: MOVLW 74	0876: MOVF 58,W	0897: MOVLW 2F	08B8: ADDWF 5F,W
0855: MOVWF 37	0877: MOVWF 49	0898: ADDWF 5F,W	08B9: MOVWF FSR
0856: MOVLW 20	0878: MOVLW 30	0899: MOVWF FSR	08BA: BCF STATUS.7
0857: MOVWF 38	0879: ADDWF 49,F	089A: BCF STATUS.7	08BB: MOVF INDF,W
0858: MOVLW 4F	087A: MOVLW 20	089B: MOVF INDF,W	08BC: MOVWF 61
0859: MOVWF 39	087B: MOVWF 4A	089C: MOVWF 61	08BD: MOVWF c
085A: MOVLW 66	087C: MOVLW 25	089D: MOVWF c	08BE: BCF PCLATH.3
085B: MOVWF 3A	087D: MOVWF 4B	089E: BCF PCLATH.3	08BF: CALL lcd_putc
085C: MOVWF 3B	087E: MOVLW 52	089F: CALL lcd_putc	08C0: BSF PCLATH.3
085D: MOVLW 73	087F: MOVWF 4C	08A0: BSF PCLATH.3	08C1: INCF 5F,F

08C2: GOTO 0B3	052B: BCF STATUS.5	0545: MOVWF Temp_in_f	055F: MOVF @77,W
08C3: BSF PCLATH.3	052C: CALL @ITOF	0546: MOVF	0560: BSF STATUS.5
08C4: BCF PCLATH.4	052D: MOVF @7A,W	RH_in_f+3,W	0561: MOVWF @@20
08C5: GOTO 3E0	052E: MOVWF	0547: BSF STATUS.5	0562: MOVF @78,W
04A5: MOVF @78,W	RH_in_f+3	0548: MOVWF ??65535+3	0563: MOVWF @@21
04A6: BCF STATUS.5	052F: MOVF @79,W	0549: BCF STATUS.5	0564: MOVF @79,W
04A7: ADDWF error,F	0530: MOVWF	054A: MOVF	0565: MOVWF @@22
0512: MOVF @78,W	RH_in_f+2	RH_in_f+2,W	0566: MOVF @7A,W
0513: BCF STATUS.5	0531: MOVF @78,W	054B: BSF STATUS.5	0567: MOVWF @@23
0514: ADDWF error,F	0532: MOVWF	054C: MOVWF	0568: BCF STATUS.5
0515: MOVF error,F	RH_in_f+1	??65535+2	0569: MOVF
0516: BTFSK STATUS.2	0533: MOVF @77,W	054D: BCF STATUS.5	RH_in_f+3,W
0517: GOTO 524	0534: MOVWF RH_in_f	054E: MOVF	056A: BSF STATUS.5
0518: CALL s_softreset	0535: MOVF	RH_in_f+1,W	056B: MOVWF
0519: MOVLW 14	temp_val_l+1,W	054F: BSF STATUS.5	??65535+3
051A: BSF STATUS.5	0536: BSF STATUS.5	0550: MOVWF ??65535+1	056C: BCF STATUS.5
051B: MOVWF ??65535	0537: MOVWF ??65535+1	0551: BCF STATUS.5	056D: MOVF
051C: BCF STATUS.5	0538: BCF STATUS.5	0552: MOVF RH_in_f,W	RH_in_f+2,W
051D: CALL @delay_msl	0539: MOVF	0553: BSF STATUS.5	056E: BSF STATUS.5
051E: MOVLW 01	temp_val_l,W	0554: MOVWF ??65535	056F: MOVWF ??65535+2
051F: BSF STATUS.5	053A: BSF STATUS.5	0555: MOVLW 54	0570: BCF STATUS.5
0520: MOVWF value	053B: MOVWF ??65535	0556: MOVWF	0571: MOVF
0521: BCF STATUS.5	053C: BCF STATUS.5	@MULFF.P1+3	RH_in_f+1,W
0522: CALL s_write_reg	053D: CALL @ITOF	0557: MOVLW E3	0572: BSF STATUS.5
0523: GOTO 65B	053E: MOVF @7A,W	0558: MOVWF	0573: MOVWF ??65535+1
0524: MOVF	053F: MOVWF	@MULFF.P1+2	0574: BCF STATUS.5
humi_val_l+1,W	Temp_in_f+3	0559: MOVLW 25	0575: MOVF RH_in_f,W
0525: BSF STATUS.5	0540: MOVF @79,W	055A: MOVWF	0576: BSF STATUS.5
0526: MOVWF ??65535+1	0541: MOVWF	@MULFF.P1+1	0577: MOVWF ??65535
0527: BCF STATUS.5	Temp_in_f+2	055B: MOVLW 7E	0578: BCF STATUS.5
0528: MOVF	0542: MOVF @78,W	055C: MOVWF	0579: MOVF
humi_val_l,W	0543: MOVWF	@MULFF.P1	RH_in_f+3,W
0529: BSF STATUS.5	Temp_in_f+1	055D: BCF STATUS.5	057A: BSF STATUS.5
052A: MOVWF ??65535	0544: MOVF @77,W	055E: CALL @MULFF	057B: MOVWF

@MULFF.P1+3	0598: MOVF @@24,W	@ADDFP.P1+2	05CC: CLRF
057C: BCF STATUS.5	0599: MOVWF ??65535	05B2: MOVF @78,W	@ADDFP.P1+1
057D: MOVF	059A: MOVLW 62	05B3: MOVWF	05CD: MOVLW 81
RH_in_f+2,W	059B: MOVWF	@ADDFP.P1+1	05CE: MOVWF
057E: BSF STATUS.5	@MULFF.P1+3	05B4: MOVF @77,W	@ADDFP.P1
057F: MOVWF	059C: MOVLW BE	05B5: MOVWF	05CF: BCF STATUS.5
@MULFF.P1+2	059D: MOVWF	@ADDFP.P1	05D0: CALL @ADDFP
0580: BCF STATUS.5	@MULFF.P1+2	05B6: BCF STATUS.5	05D1: MOVF @7A,W
0581: MOVF	059E: MOVLW 3C	05B7: CALL @ADDFP	05D2: MOVWF
RH_in_f+1,W	059F: MOVWF	05B8: MOVF @77,W	RH_real+3
0582: BSF STATUS.5	@MULFF.P1+1	05B9: BSF STATUS.5	05D3: MOVF @79,W
0583: MOVWF	05A0: MOVLW 74	05BA: MOVWF @@28	05D4: MOVWF
@MULFF.P1+1	05A1: MOVWF	05BB: MOVF @78,W	RH_real+2
0584: BCF STATUS.5	@MULFF.P1	05BC: MOVWF @@29	05D5: MOVF @78,W
0585: MOVF RH_in_f,W	05A2: BCF STATUS.5	05BD: MOVF @79,W	05D6: MOVWF
0586: BSF STATUS.5	05A3: CALL @MULFF	05BE: MOVWF @@2A	RH_real+1
0587: MOVWF	05A4: BSF STATUS.1	05BF: MOVF @7A,W	05D7: MOVF @77,W
@MULFF.P1	05A5: BSF STATUS.5	05C0: MOVWF @@2B	05D8: MOVWF RH_real
0588: BCF STATUS.5	05A6: MOVF @@23,W	05C1: BSF STATUS.1	05D9: MOVF
0589: CALL @MULFF	05A7: MOVWF	05C2: MOVF @@2B,W	RH_real+3,W
058A: MOVF @77,W	??65535+3	05C3: MOVWF	05DA: BSF STATUS.5
058B: BSF STATUS.5	05A8: MOVF @@22,W	??65535+3	05DB: MOVWF
058C: MOVWF @@24	05A9: MOVWF	05C4: MOVF @@2A,W	??65535+3
058D: MOVF @78,W	??65535+2	05C5: MOVWF	05DC: BCF STATUS.5
058E: MOVWF @@25	05AA: MOVF @@21,W	??65535+2	05DD: MOVF
058F: MOVF @79,W	05AB: MOVWF	05C6: MOVF @@29,W	RH_real+2,W
0590: MOVWF @@26	??65535+1	05C7: MOVWF	05DE: BSF STATUS.5
0591: MOVF @7A,W	05AC: MOVF @@20,W	??65535+1	05DF: MOVWF
0592: MOVWF @@27	05AD: MOVWF ??65535	05C8: MOVF @@28,W	??65535+2
0593: MOVWF ??65535+3	05AE: MOVF @7A,W	05C9: MOVWF ??65535	05E0: BCF STATUS.5
0594: MOVF @@26,W	05AF: MOVWF	05CA: CLRF	05E1: MOVF
0595: MOVWF ??65535+2	@ADDFP.P1+3	@ADDFP.P1+3	RH_real+1,W
0596: MOVF @@25,W	05B0: MOVF @79,W	05CB: CLRF	05E2: BSF STATUS.5
0597: MOVWF ??65535+1	05B1: MOVWF	@ADDFP.P1+2	05E3: MOVWF

??65535+1	05FE: MOVWF	@ADDFP.P1+1	Temp_real,W
05E4: BCF STATUS.5	@MULFF.P1+2	061B: MOVLW 84	0634: BSF STATUS.5
05E5: MOVF RH_real,W	05FF: MOVLW 23	061C: MOVWF	0635: MOVWF ??65535
05E6: BSF STATUS.5	0600: MOVWF	@ADDFP.P1	0636: CLRF
05E7: MOVWF ??65535	@MULFF.P1+1	061D: BCF STATUS.5	@MULFF.P1+3
05E8: BCF STATUS.5	0601: MOVLW @7A	061E: CALL @ADDFP	0637: CLRF
05E9: CALL @SFTOI	0602: MOVWF	061F: MOVF @7A,W	@MULFF.P1+2
05EA: MOVF @78,W	@MULFF.P1	0620: MOVWF	0638: MOVLW 20
05EB: MOVWF	0603: BCF STATUS.5	Temp_real+3	0639: MOVWF
percent_RH	0604: CALL @MULFF	0621: MOVF @79,W	@MULFF.P1+1
05EC: MOVF	0605: MOVF @77,W	0622: MOVWF	063A: MOVLW 82
Temp_in_f+3,W	0606: BSF STATUS.5	Temp_real+2	063B: MOVWF
05ED: BSF STATUS.5	0607: MOVWF @@20	0623: MOVF @78,W	@MULFF.P1
05EE: MOVWF	0608: MOVF @78,W	0624: MOVWF	063C: BCF STATUS.5
??65535+3	0609: MOVWF @@21	Temp_real+1	063D: CALL @MULFF
05EF: BCF STATUS.5	060A: MOVF @79,W	0625: MOVF @77,W	063E: MOVF @7A,W
05F0: MOVF	060B: MOVWF @@22	0626: MOVWF Temp_real	063F: MOVWF
Temp_in_f+2,W	060C: MOVF @7A,W	0627: MOVF	Temp_real+3
05F1: BSF STATUS.5	060D: MOVWF @@23	Temp_real+3,W	0640: MOVF @79,W
05F2: MOVWF ??65535+2	060E: BSF STATUS.1	0628: BSF STATUS.5	0641: MOVWF
05F3: BCF STATUS.5	060F: MOVF @@23,W	0629: MOVWF ??65535+3	Temp_real+2
05F4: MOVF	0610: MOVWF ??65535+3	062A: BCF STATUS.5	0642: MOVF @78,W
Temp_in_f+1,W	0611: MOVF @@22,W	062B: MOVF	0643: MOVWF
05F5: BSF STATUS.5	0612: MOVWF ??65535+2	Temp_real+2,W	Temp_real+1
05F6: MOVWF ??65535+1	0613: MOVF @@21,W	062C: BSF STATUS.5	0644: MOVF @77,W
05F7: BCF STATUS.5	0614: MOVWF ??65535+1	062D: MOVWF	0645: MOVWF Temp_real
05F8: MOVF	0615: MOVF @@20,W	??65535+2	0646: MOVF
Temp_in_f,W	0616: MOVWF ??65535	062E: BCF STATUS.5	Temp_real+3,W
05F9: BSF STATUS.5	0617: CLRF	062F: MOVF	0647: BSF STATUS.5
05FA: MOVWF ??65535	@ADDFP.P1+3	Temp_real+1,W	0648: MOVWF ??65535+3
05FB: MOVLW 0A	0618: CLRF	0630: BSF STATUS.5	0649: BCF STATUS.5
05FC: MOVWF	@ADDFP.P1+2	0631: MOVWF ??65535+1	064A: MOVF
@MULFF.P1+3	0619: MOVLW 20	0632: BCF STATUS.5	Temp_real+2,W
05FD: MOVLW D7	061A: MOVWF	0633: MOVF	064B: BSF STATUS.5

064C: MOVWF ??65535+2	08D1: NOP	08F3: MOVF PORTD,W	0915: MOVWF key
064D: BCF STATUS.5	08D2: MOVF PORTD,W	08F4: MOVWF key	0916: MOVLW 70
064E: MOVF Temp_real+1,W	08D3: MOVWF key	08F5: MOVLW 70	0917: ANDWF key,F
064F: BSF STATUS.5	08D4: MOVLW 70	08F6: ANDWF key,F	0918: MOVF key,W
0650: MOVWF ??65535+1	08D5: ANDWF key,F	08F7: MOVF key,W	0919: XORLW 30
0651: BCF STATUS.5	08D6: MOVF key,W	08F8: XORLW 30	091A: BTFSC STATUS.2
0652: MOVF Temp_real,W	08D7: XORLW 30	08F9: BTFSC STATUS.2	091B: GOTO 123
0653: BSF STATUS.5	08D8: BTFSC STATUS.2	08FA: GOTO 102	091C: XORLW 60
0654: MOVWF ??65535	08D9: GOTO 0E1	08FB: XORLW 60	091D: BTFSC STATUS.2
0655: BCF STATUS.5	08DA: XORLW 60	08FC: BTFSC STATUS.2	091E: GOTO 126
0656: CALL @SFTOI	08DB: BTFSC STATUS.2	08FD: GOTO 105	091F: XORLW 30
0657: MOVF @79,W	08DC: GOTO 0E4	08FE: XORLW 30	0920: BTFSC STATUS.2
0658: MOVWF temperature+1	08DD: XORLW 30	08FF: BTFSC STATUS.2	0921: GOTO 129
0659: MOVF @78,W	08DE: BTFSC STATUS.2	0900: GOTO 108	0922: GOTO 12C
065A: MOVWF temperature	08DF: GOTO 0E7	0901: GOTO 10B	0923: MOVLW 04
065B: BSF PCLATH.3	08E0: GOTO 0EA	0902: MOVLW 07	0924: MOVWF KeyIN
065C: BCF PCLATH.4	08E1: MOVLW 0A	0903: MOVWF KeyIN	0925: GOTO 12C
065D: GOTO 3D3	08E2: MOVWF KeyIN	0904: GOTO 10B	0926: MOVLW 05
08C6: CLRF KeyIN	08E3: GOTO 0EA	0905: MOVLW 08	0927: MOVWF KeyIN
08C7: BTFSC 54.0	08E4: MOVLW 0B	0906: MOVWF KeyIN	0928: GOTO 12C
08C8: GOTO 14E	08E5: MOVWF KeyIN	0907: GOTO 10B	0929: MOVLW 06
08C9: MOVLW 7E	08E6: GOTO 0EA	0908: MOVLW 09	092A: MOVWF KeyIN
08CA: MOVWF PORTD	08E7: MOVLW 0C	0909: MOVWF KeyIN	092B: GOTO 12C
08CB: CLRWDT	08E8: MOVWF KeyIN	090A: GOTO 10B	092C: MOVLW @77
08CC: MOVLW 52	08E9: GOTO 0EA	090B: MOVLW @7B	092D: MOVWF PORTD
08CD: MOVWF @77	08EA: MOVLW 7D	090C: MOVWF PORTD	092E: CLRWDT
08CE: DECFSZ @77,F	08EB: MOVWF PORTD	090D: CLRWDT	092F: MOVLW 52
08CF: GOTO 0CE	08EC: CLRWDT	090E: MOVLW 52	0930: MOVWF @77
08D0: NOP	08ED: MOVLW 52	090F: MOVWF @77	0931: DECFSZ @77,F
	08EE: MOVWF @77	0910: DECFSZ @77,F	0932: GOTO 131
	08EF: DECFSZ @77,F	0911: GOTO 110	0933: NOP
	08F0: GOTO 0EF	0912: NOP	0934: NOP
	08F1: NOP	0913: NOP	0935: MOVF PORTD,W
	08F2: NOP	0914: MOVF PORTD,W	0936: MOVWF key

0937: MOVLW 70	0957: MOVWF @77	0979: GOTO 188	099B: MOVLW 02
0938: ANDWF key,F	0958: DECFSZ @77,F	097A: MOVLW 01	099C: MOVWF 56
0939: MOVF key,W	0959: GOTO 158	097B: MOVWF 55	099D: MOVLW 01
093A: XORLW 30	095A: NOP	097C: MOVLW 02	099E: MOVWF 57
093B: BTFSC STATUS.2	095B: NOP	097D: MOVWF 57	099F: GOTO 1A5
093C: GOTO 144	095C: MOVF PORTD,W	097E: GOTO 188	09A0: MOVLW 02
093D: XORLW 60	095D: MOVWF key	097F: MOVLW 01	09A1: MOVWF 58
093E: BTFSC STATUS.2	095E: MOVLW 70	0980: MOVWF 56	09A2: MOVLW 03
093F: GOTO 147	095F: ANDWF key,F	0981: MOVWF 57	09A3: MOVWF 57
0940: XORLW 30	0960: MOVF key,W	0982: GOTO 188	09A4: GOTO 1A5
0941: BTFSC STATUS.2	0961: SUBLW 70	0983: MOVLW 01	09A5: BSF 54.0
0942: GOTO 14A	0962: BTFSS STATUS.2	0984: MOVWF 58	09A6: MOVLW 0A
0943: GOTO 14D	0963: GOTO 165	0985: MOVLW 03	09A7: MOVWF 52
0944: MOVLW 01	0964: BCF FlagKey	0986: MOVWF 57	09A8: GOTO 30B
0945: MOVWF KeyIN	0965: BSF PCLATH.3	0987: GOTO 188	09A9: MOVF 57,W
0946: GOTO 14D	0966: BCF PCLATH.4	0988: BSF 54.0	09AA: XORLW 01
0947: MOVLW 02	0967: GOTO 3E1	0989: MOVLW 0A	09AB: BTFSC STATUS.2
0948: MOVWF KeyIN	0968: MOVLW 01	098A: MOVWF 52	09AC: GOTO 1B4
0949: GOTO 14D	0969: SUBWF 51,W	098B: GOTO 30B	09AD: XORLW 03
094A: MOVLW 03	096A: ADDLW F4	098C: MOVF 57,W	09AE: BTFSC STATUS.2
094B: MOVWF KeyIN	096B: BTFSC STATUS.0	098D: XORLW 01	09AF: GOTO 1B9
094C: GOTO 14D	096C: GOTO 30B	098E: BTFSC STATUS.2	09B0: XORLW 01
094D: GOTO 165	096D: ADDLW 0C	098F: GOTO 197	09B1: BTFSC STATUS.2
094E: MOVF	096E: GOTO @goto10524	0990: XORLW 03	09B2: GOTO 1BE
TimeDelayKey,F	096F: MOVF 57,W	0991: BTFSC STATUS.2	09B3: GOTO 1C2
094F: BTFSC STATUS.2	0970: XORLW 01	0992: GOTO 19B	09B4: MOVLW 03
0950: GOTO 153	0971: BTFSC STATUS.2	0993: XORLW 01	09B5: MOVWF 55
0951: DECF	0972: GOTO 17A	0994: BTFSC STATUS.2	09B6: MOVLW 02
TimeDelayKey,F	0973: XORLW 03	0995: GOTO 1A0	09B7: MOVWF 57
0952: GOTO 165	0974: BTFSC STATUS.2	0996: GOTO 1A5	09B8: GOTO 1C2
0953: MOVLW 70	0975: GOTO 17F	0997: MOVLW 02	09B9: MOVLW 03
0954: MOVWF PORTD	0976: XORLW 01	0998: MOVWF 55	09BA: MOVWF 56
0955: CLRWDT	0977: BTFSC STATUS.2	0999: MOVWF 57	09BB: MOVLW 01
0956: MOVLW 52	0978: GOTO 183	099A: GOTO 1A5	09BC: MOVWF 57

09BD: GOTO 1C2	09DF: GOTO 1E0	0A01: GOTO 30B	0A23: GOTO 22B
09BE: MOVLW 03	09E0: BSF 54.0	0A02: MOVF 57,W	0A24: XORLW 03
09BF: MOVWF 58	09E1: MOVLW 0A	0A03: XORLW 01	0A25: BTFSC STATUS.2
09C0: MOVWF 57	09E2: MOVWF 52	0A04: BTFSC STATUS.2	0A26: GOTO 230
09C1: GOTO 1C2	09E3: GOTO 30B	0A05: GOTO 20D	0A27: XORLW 01
09C2: BSF 54.0	09E4: MOVF 57,W	0A06: XORLW 03	0A28: BTFSC STATUS.2
09C3: MOVLW 0A	09E5: XORLW 01	0A07: BTFSC STATUS.2	0A29: GOTO 235
09C4: MOVWF 52	09E6: BTFSC STATUS.2	0A08: GOTO 212	0A2A: GOTO 23A
09C5: GOTO 30B	09E7: GOTO 1EF	0A09: XORLW 01	0A2B: MOVLW 07
09C6: MOVF 57,W	09E8: XORLW 03	0A0A: BTFSC STATUS.2	0A2C: MOVWF 55
09C7: XORLW 01	09E9: BTFSC STATUS.2	0A0B: GOTO 217	0A2D: MOVLW 02
09C8: BTFSC STATUS.2	09EA: GOTO 1F4	0A0C: GOTO 21C	0A2E: MOVWF 57
09C9: GOTO 1D1	09EB: XORLW 01	0A0D: MOVLW 06	0A2F: GOTO 23A
09CA: XORLW 03	09EC: BTFSC STATUS.2	0A0E: MOVWF 55	0A30: MOVLW 07
09CB: BTFSC STATUS.2	09ED: GOTO 1F9	0A0F: MOVLW 02	0A31: MOVWF 56
09CC: GOTO 1D6	09EE: GOTO 1FE	0A10: MOVWF 57	0A32: MOVLW 01
09CD: XORLW 01	09EF: MOVLW 05	0A11: GOTO 21C	0A33: MOVWF 57
09CE: BTFSC STATUS.2	09F0: MOVWF 55	0A12: MOVLW 06	0A34: GOTO 23A
09CF: GOTO 1DB	09F1: MOVLW 02	0A13: MOVWF 56	0A35: MOVLW 07
09D0: GOTO 1E0	09F2: MOVWF 57	0A14: MOVLW 01	0A36: MOVWF 58
09D1: MOVLW 04	09F3: GOTO 1FE	0A15: MOVWF 57	0A37: MOVLW 03
09D2: MOVWF 55	09F4: MOVLW 05	0A16: GOTO 21C	0A38: MOVWF 57
09D3: MOVLW 02	09F5: MOVWF 56	0A17: MOVLW 06	0A39: GOTO 23A
09D4: MOVWF 57	09F6: MOVLW 01	0A18: MOVWF 58	0A3A: BSF 54.0
09D5: GOTO 1E0	09F7: MOVWF 57	0A19: MOVLW 03	0A3B: MOVLW 0A
09D6: MOVLW 04	09F8: GOTO 1FE	0A1A: MOVWF 57	0A3C: MOVWF 52
09D7: MOVWF 56	09F9: MOVLW 05	0A1B: GOTO 21C	0A3D: GOTO 30B
09D8: MOVLW 01	09FA: MOVWF 58	0A1C: BSF 54.0	0A3E: MOVF 57,W
09D9: MOVWF 57	09FB: MOVLW 03	0A1D: MOVLW 0A	0A3F: XORLW 01
09DA: GOTO 1E0	09FC: MOVWF 57	0A1E: MOVWF 52	0A40: BTFSC STATUS.2
09DB: MOVLW 04	09FD: GOTO 1FE	0A1F: GOTO 30B	0A41: GOTO 249
09DC: MOVWF 58	09FE: BSF 54.0	0A20: MOVF 57,W	0A42: XORLW 03
09DD: MOVLW 03	09FF: MOVLW 0A	0A21: XORLW 01	0A43: BTFSC STATUS.2
09DE: MOVWF 57	0A00: MOVWF 52	0A22: BTFSC STATUS.2	0A44: GOTO 24E

0A45: XORLW 01	0A67: MOVLW 09	0A87: BCF PCLATH.3	0AA6: MOVF 57,W
0A46: BTFSC STATUS.2	0A68: MOVWF 55	0A88: CALL @DIV88	0AA7: XORLW 01
0A47: GOTO 253	0A69: MOVLW 02	0A89: BSF PCLATH.3	0AA8: BTFSC STATUS.2
0A48: GOTO 258	0A6A: MOVWF 57	0A8A: MOVF @78,W	0AA9: GOTO 2AE
0A49: MOVLW 08	0A6B: GOTO 276	0A8B: MOVWF 55	0AAA: XORLW 03
0A4A: MOVWF 55	0A6C: MOVLW 09	0A8C: MOVF	0AAB: BTFSC STATUS.2
0A4B: MOVLW 02	0A6D: MOVWF 56	SetPointHumid,W	0AAC: GOTO 2B2
0A4C: MOVWF 57	0A6E: MOVLW 01	0A8D: MOVWF ??65535	0AAD: GOTO 2B6
0A4D: GOTO 258	0A6F: MOVWF 57	0A8E: MOVLW 0A	0AAE: CLRF 55
0A4E: MOVLW 08	0A70: GOTO 276	0A8F: MOVWF	0AAF: MOVLW 02
0A4F: MOVWF 56	0A71: MOVLW 09	@DIV88.P1	0AB0: MOVWF 57
0A50: MOVLW 01	0A72: MOVWF 58	0A90: BCF PCLATH.3	0AB1: GOTO 2B6
0A51: MOVWF 57	0A73: MOVLW 03	0A91: CALL @DIV88	0AB2: CLRF 56
0A52: GOTO 258	0A74: MOVWF 57	0A92: BSF PCLATH.3	0AB3: MOVLW 01
0A53: MOVLW 08	0A75: GOTO 276	0A93: MOVF @77,W	0AB4: MOVWF 57
0A54: MOVWF 58	0A76: BSF 54.0	0A94: MOVWF 56	0AB5: GOTO 2B6
0A55: MOVLW 03	0A77: MOVLW 0A	0A95: GOTO 2A2	0AB6: BTFSC 54.3
0A56: MOVWF 57	0A78: MOVWF 52	0A96: MOVLW 03	0AB7: GOTO 2BB
0A57: GOTO 258	0A79: GOTO 30B	0A97: MOVWF 57	0AB8: BSF 54.3
0A58: BSF 54.0	0A7A: BTFSS 54.1	0A98: MOVF sp1,W	0AB9: BCF PORTC.3
0A59: MOVLW 0A	0A7B: GOTO 280	0A99: MOVWF ??65535	0ABA: GOTO 2BC
0A5A: MOVWF 52	0A7C: MOVF 57,W	0A9A: MOVLW 0A	0ABB: BCF 54.3
0A5B: GOTO 30B	0A7D: SUBLW 03	0A9B: MOVWF	0ABC: BSF 54.0
0A5C: MOVF 57,W	0A7E: BTFSS STATUS.2	@MUL88.P1	0ABD: MOVLW 0A
0A5D: XORLW 01	0A7F: GOTO 296	0A9C: BCF PCLATH.3	0ABE: MOVWF 52
0A5E: BTFSC STATUS.2	0A80: BSF 54.1	0A9D: CALL @MUL88	0ABF: GOTO 30B
0A5F: GOTO 267	0A81: MOVLW 01	0A9E: BSF PCLATH.3	0AC0: BTFSS 54.1
0A60: XORLW 03	0A82: MOVWF 57	0A9F: MOVF 56,W	0AC1: GOTO 307
0A61: BTFSC STATUS.2	0A83: MOVF	0AA0: ADDWF @78,W	0AC2: BCF 54.1
0A62: GOTO 26C	SetPointHumid,W	0AA1: MOVWF 53	0AC3: CLRF 57
0A63: XORLW 01	0A84: MOVWF ??65535	0AA2: BSF 54.0	0AC4: MOVF sp1,W
0A64: BTFSC STATUS.2	0A85: MOVLW 0A	0AA3: MOVLW 0A	0AC5: MOVWF ??65535
0A65: GOTO 271	0A86: MOVWF	0AA4: MOVWF 52	0AC6: MOVLW 0A
0A66: GOTO 276	@DIV88.P1	0AA5: GOTO 30B	0AC7: MOVWF

@MUL88.P1	0AE8: BCF STATUS.6	0B09: MOVWF 52	07B3: BCF PORTC.3
0AC8: BCF PCLATH.3	0AE9: IORWF INTCON,F	0B0A: GOTO 30B	07B4: BCF FRelayOnOff
0AC9: CALL @MUL88	0AEA: MOVLW 01	0B0B: BSF PCLATH.3	07B5: BSF PORTC.2
0ACA: BSF PCLATH.3	0AEB: BSF STATUS.6	0B0C: BCF PCLATH.4	07B6: BCF FlagOverSet
0ACB: MOVF 56,W	0AEC: MOVWF EEDR	0B0D: GOTO 3E2	07B7: CLRF TimeFan
0ACC: ADDWF @78,W	0AED: BCF STATUS.6	079A: MOVF	07B8: GOTO 7BE
0ACD: MOVWF 53	0AEE: MOVF 58,W	SetPointHumid,W	07B9: BCF PORTC.3
0ACE: BSF STATUS.6	0AEF: BSF STATUS.6	079B: SUBWF	07BA: BCF FRelayOnOff
0ACF: CLRF EEDR	0AF0: MOVWF EEDATA	percent_RH,W	07BB: BSF PORTC.2
0AD0: BCF STATUS.6	0AF1: BSF STATUS.5	079C: BTFSS STATUS.0	07BC: BCF FlagOverSet
0AD1: MOVF 53,W	0AF2: BCF EECON1.7	079D: GOTO 7AA	07BD: CLRF TimeFan
0AD2: BSF STATUS.6	0AF3: BSF EECON1.2	079E: BTFSS 54.3	07BE: BSF PCLATH.3
0AD3: MOVWF EEDATA	0AF4: BCF STATUS.5	079F: BSF PORTC.3	07BF: BCF PCLATH.4
0AD4: BSF STATUS.5	0AF5: BCF STATUS.6	07A0: BSF FlagOverSet	07C0: GOTO 3D9
0AD5: BCF EECON1.7	0AF6: MOVF	07A1: INCF TimeFan,F	** int_TIMER0
0AD6: BSF EECON1.2	INTCON,W	07A2: MOVF TimeFan,W	0074: CLRWDT
0AD7: BCF STATUS.5	0AF7: MOVWF @77	07A3: SUBLW B4	0075: INCF time_c,F
0AD8: BCF STATUS.6	0AF8: BCF INTCON.7	07A4: BTFSC STATUS.0	0076: INCF 5C,F
0AD9: MOVF	0AF9: BSF STATUS.5	07A5: GOTO 7A9	0077: BTFSC STATUS.2
INTCON,W	0AFA: BSF STATUS.6	07A6: BCF PORTC.2	0078: INCF sec+1,F
0ADA: MOVWF @77	0AFB: MOVLW 55	07A7: MOVLW B4	0079: MOVF sec+1,W
0ADB: BCF INTCON.7	0AFC: MOVWF EECON2	07A8: MOVWF TimeFan	007A: SUBLW 01
0ADC: BSF STATUS.5	0AFD: MOVLW AA	07A9: GOTO 7BE	007B: BTFSS STATUS.0
0ADD: BSF STATUS.6	0AFE: MOVWF EECON2	07AA: BTFSS 54.2	007C: GOTO 085
0ADE: MOVLW 55	0AFF: BSF EECON1.1	07AB: GOTO 7B9	007D: BTFSS STATUS.2
0ADF: MOVWF EECON2	0B00: BTFSC EECON1.1	07AC: MOVF 58,W	007E: GOTO 083
0AE0: MOVLW AA	0B01: GOTO 300	07AD: SUBWF	007F: MOVF sec,W
0AE1: MOVWF EECON2	0B02: BCF EECON1.2	SetPointHumid,W	0080: SUBLW F3
0AE2: BSF EECON1.1	0B03: MOVF @77,W	07AE: SUBWF	0081: BTFSS STATUS.0
0AE3: BTFSC EECON1.1	0B04: BCF STATUS.5	percent_RH,W	0082: GOTO 085
0AE4: GOTO 2E3	0B05: BCF STATUS.6	07AF: BTFSC STATUS.2	0083: BSF PORTA.0
0AE5: BCF EECON1.2	0B06: IORWF INTCON,F	07B0: GOTO 7B3	0084: GOTO 086
0AE6: MOVF @77,W	0B07: BSF 54.0	07B1: BTFSC STATUS.0	0085: BCF PORTA.0
0AE7: BCF STATUS.5	0B08: MOVLW 0A	07B2: GOTO 7B8	0086: BCF INTCON.2

0087: BCF PCLATH.3	0B3C: BCF @TRIS_C.5	0B5B: BCF STATUS.5	0B7C: BSF PCLATH.3
0088: BCF PCLATH.4	0B3D: MOVF	0B5C: BSF INTCON.5	0B7D: DECFSZ @@5F,F
0089: GOTO 01D	@TRIS_C,W	0B5D: MOVLW C0	0B7E: GOTO 376
0B1E: CLRF FSR	0B3E: BSF STATUS.5	0B5E: IORWF INTCON,F	0B7F: BCF PCLATH.3
0B1F: BCF STATUS.7	0B3F: MOVWF TRISC	0B5F: MOVLW 00	0B80: CALL s_softreset
0B20: MOVLW 1F	0B40: BCF STATUS.5	0B60: BSF STATUS.5	0B81: BSF PCLATH.3
0B21: ANDWF	0B41: BSF @TRIS_C.4	0B61: MOVWF TRISA	0B82: MOVLW 14
STATUS,F	0B42: MOVF	0B62: MOVLW 01	0B83: BSF STATUS.5
0B22: BSF STATUS.5	@TRIS_C,W	0B63: MOVWF TRISB	0B84: MOVWF ??65535
0B23: BSF ADCON1.0	0B43: BSF STATUS.5	0B64: MOVLW 00	0B85: BCF PCLATH.3
0B24: BSF ADCON1.1	0B44: MOVWF TRISC	0B65: MOVWF TRISC	0B86: BCF STATUS.5
0B25: BSF ADCON1.2	0B45: BCF STATUS.5	0B66: BCF STATUS.5	0B87: CALL @delay_ms1
0B26: BCF ADCON1.3	0B46: BCF @TRIS_C.3	0B67: MOVWF @TRIS_C	0B88: BSF PCLATH.3
0B27: MOVLW 40	0B47: MOVF	0B68: MOVLW 70	0B89: MOVLW 01
0B28: MOVWF SPBRG	@TRIS_C,W	0B69: BSF STATUS.5	0B8A: BSF STATUS.5
0B29: MOVLW 26	0B48: BSF STATUS.5	0B6A: MOVWF TRISD	0B8B: MOVWF value
0B2A: MOVWF TXSTA	0B49: MOVWF TRISC	0B6B: BCF TRISE.0	0B8C: BCF PCLATH.3
0B2B: MOVLW 90	0B4A: MOVLW 00	0B6C: BCF TRISE.1	0B8D: BCF STATUS.5
0B2C: BCF STATUS.5	0B4B: BCF STATUS.5	0B6D: BCF TRISE.2	0B8E: CALL s_write_reg
0B2D: MOVWF RCSTA	0B4C: MOVWF SSPCON	0B6E: MOVLW 01	0B8F: BSF PCLATH.3
0B30: BSF STATUS.5	0B4D: BSF STATUS.5	0B6F: BCF STATUS.5	0B90: MOVLW 64
0B31: BCF OPTION.7	0B4E: MOVWF SSPSTAT	0B70: MOVWF PORTB	0B91: BSF STATUS.5
0B32: BSF ADCON1.0	0B4F: MOVF OPTION,W	0B71: CLRF PORTC	0B92: MOVWF ??65535
0B33: BSF ADCON1.1	0B50: ANDLW C0	0B72: MOVLW 70	0B93: BCF PCLATH.3
0B34: BSF ADCON1.2	0B51: IORLW 02	0B73: MOVWF PORTD	0B94: BCF STATUS.5
0B35: BCF ADCON1.3	0B52: MOVWF OPTION	0B74: MOVLW 02	0B95: CALL @delay_ms1
0B36: BCF STATUS.5	0B53: BCF STATUS.5	0B75: MOVWF @@5F	0B96: BSF PCLATH.3
0B37: BCF ADCON0.0	0B54: CLRF TICON	0B76: MOVLW FA	0B97: BCF PCLATH.3
0B38: BSF STATUS.5	0B55: MOVLW 00	0B77: BSF STATUS.5	0B98: GOTO lcd_init
0B39: BCF TRISE.4	0B56: MOVWF @78	0B78: MOVWF ??65535	0B99: BSF PCLATH.3
0B2E: MOVLW FF	0B57: MOVWF T2CON	0B79: BCF PCLATH.3	0B9A: BCF PCLATH.3
0B2F: MOVWF @TRIS_C	0B58: MOVLW 00	0B7A: BCF STATUS.5	0B9B: GOTO
0B3A: BCF STATUS.5	0B59: BSF STATUS.5	0B7B: CALL	begin_show_logo
0B3B: BCF SSPCON.5	0B5A: MOVWF PR2	@delay_ms1	0B9C: BSF PCLATH.3

0B9D: CLRF time_c	0BBB: BSF PORTC.2	0BDA: GOTO 3E0
0B9E: CLRF sec+1	0BBC: BCF	0BDB: MOVLW 03
0B9F: CLRF sec	FRelayOnOff	0BDC: MOVWF sec+1
0BA0: CLRF KeyIN	0BBD: MOVF time_c,W	0BDD: MOVLW E8
0BA1: BCF FlagKey	0BBE: SUBLW 13	0BDE: MOVWF sec
0BA2: CLRF	0BBF: BTFSK STATUS.0	0BDF: GOTO ShowSet
TimeDelayKey	0BC0: GOTO 3BD	0BE0: GOTO ScanKey
0BA3: BCF FlagSet	0BC1: CLRF time_c	0BE1: GOTO KeyValue
0BA4: BSF STATUS.6	0BC2: BTFSK 54.1	0BE2: GOTO 3BD
0BA5: CLRF EEADR	0BC3: GOTO 3DB	0BE3: SLEEP
0BA6: BSF STATUS.5	0BC4: MOVF sec+1,W	
0BA7: BCF EECON1.7	0BC5: SUBLW 02	
0BA8: BSF EECON1.0	0BC6: BTFSK STATUS.0	
0BA9: BCF STATUS.5	0BC7: GOTO 3DA	
0BAA: MOVF	0BC8: XORLW FF	
EEDATA,W	0BC9: BTFSK STATUS.2	
0BAB: BCF STATUS.6	0BCA: GOTO 3CF	
0BAC: MOVWF	0BCB: MOVF sec,W	
SetPointHumid	0BCC: SUBLW E8	
0BAD: MOVLW 01	0BCD: BTFSK STATUS.0	
0BAE: BSF STATUS.6	0BCE: GOTO 3DA	
0BAF: MOVWF EEADR	0BCF: CLRF sec+1	
0BB0: BSF STATUS.5	0BD0: CLRF sec	
0BB1: BCF EECON1.7	0BD1: BCF PCLATH.3	
0BB2: BSF EECON1.0	0BD2: GOTO	
0BB3: BCF STATUS.5	find_humi_temp	
0BB4: MOVF	0BD3: BSF PCLATH.3	
EEDATA,W	0BD4: BCF PCLATH.3	
0BB5: BCF STATUS.6	0BD5: GOTO	
0BB6: MOVWF OffSet	convert_show	
0BB7: CLRF StepSet	0BD6: BSF PCLATH.3	
0BB8: BCF FlagOverSet	0BD7: BCF PCLATH.3	
0BB9: CLRF TimeFan	0BD8: GOTO CheckPoint	
0BBA: BCF PORTC.3	0BD9: BSF PCLATH.3	

ภาคผนวก ข

รายละเอียดของหัววัดความชื้นและอุณหภูมิ SHT15



SHT1x / SHT7x

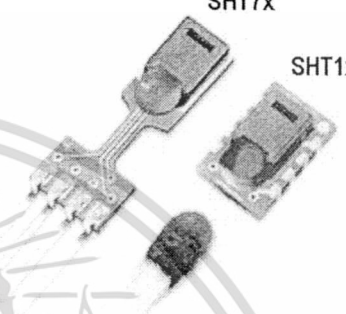
Humidity & Temperature Sensor

Evaluation Kit Available

SHT7x

SHT1x

- _ Relative humidity and temperature sensors
- _ Dew point
- _ Fully calibrated, digital output
- _ Excellent long-term stability
- _ No external components required
- _ Ultra low power consumption
- _ Surface mountable or 4-pin fully interchangeable
- _ Small size
- _ Automatic power down



SHT1x / SHT7x Product Summary

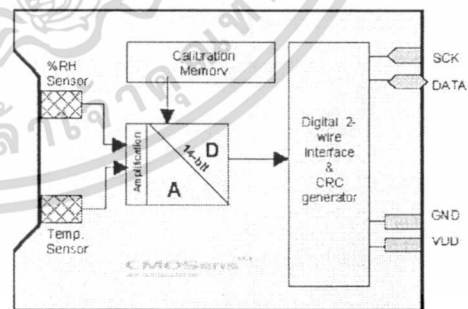
The SHTxx is a single chip relative humidity and temperature multi sensor module comprising a calibrated digital output. Application of industrial CMOS processes with patented micro-machining (CMOSens® technology) ensures highest reliability and excellent long term stability. The device includes a capacitive polymer sensing element for relative humidity and a bandgap temperature sensor. Both are seamlessly coupled to a 14bit analog to digital converter and a serial interface circuit on the same chip. This results in superior signal quality, a fast response time and insensitivity to external disturbances (EMC) at a very competitive price. Each SHTxx is individually calibrated in a precision humidity chamber with a chilled mirror hygrometer as reference. The

calibration coefficients are programmed into the OTP memory. These coefficients are used internally during measurements to calibrate the signals from the sensors. The 2-wire serial interface and internal voltage regulation allows easy and fast system integration. Its tiny size and low power consumption makes it the ultimate choice for even the most demanding applications. The device is supplied in either a surface-mountable LCC (Leadless Chip Carrier) or as a pluggable 4-pin single-in-line type package. Customer specific packaging options may be available on request.

Applications

- _ HVAC
- _ Automotive
- _ Consumer Goods
- _ Weather Stations
- _ Humidifiers
- _ Dehumidifiers
- _ Test & Measurement
- _ Data Logging
- _ Automation
- _ White Goods
- _ Medical

Block Diagram



Ordering Information

Part Number	Humidity accuracy [%RH]	Temperature accuracy [°C]	Package
SHT11	±3.5	±0.5 @ 25 °C	SMD (LCC)
SHT15	±2.0	±0.4 @ 5-40 °C	SMD (LCC)
SHT71	±3.5	±0.5 @ 25 °C	4-pin single-in-line
SHT75	±2.0	±0.4 @ 5-40 °C	4-pin single-in-line

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1 Sensor Performance Specifications

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Humidity					
Resolution ⁽²⁾		0.5	0.03	0.03	%RH
		8	12	12	bit
Repeatability		±0.1			%RH
Accuracy ⁽¹⁾	linearized	see figure 1			
Uncertainty					
Interchangeability		Fully interchangeable			
Nonlinearity	raw data	±3			%RH
	linearized	<<1			%RH
Range		0		100	%RH
Response time	1/e (63%) slowly moving air	4			s
Hysteresis		±1			%RH
Long term stability	typical	< 1			%RH/yr
Temperature					
Resolution ⁽²⁾		0.04	0.01	0.01	°C
		0.07	0.02	0.02	°F
Repeatability		±0.1			°C
		±0.2			°F
Accuracy		see figure 1			
Range		-40		123.8	°C
		-40		254.9	°F
Response Time	1/e (63%)	5		30	s

Table 1 Sensor Performance Specifications

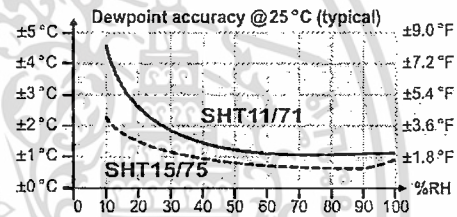
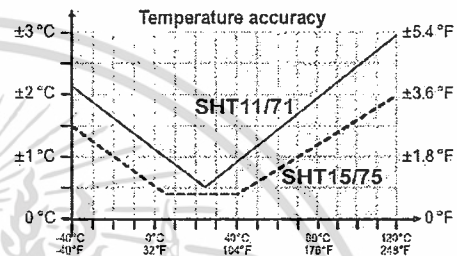
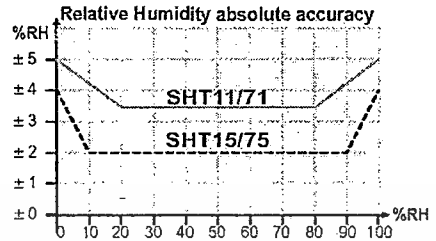


Figure 1 Rel. Humidity, Temperature and Dewpoint accuracies

2 Interface Specifications

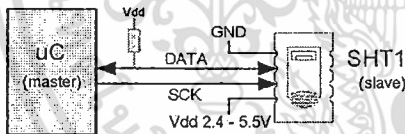


Figure 2 Typical application circuit

2.1 Power Pins

The SHTxx requires a voltage supply between 2.4 and 5.5 V. After powerup the device needs 11ms to reach its 'sleep' state. No commands should be sent before that time. Power supply pins (VDD, GND) may be decoupled with a 100 nF capacitor.

2.2 Serial Interface (Bidirectional 2-wire)

The serial interface of the SHTxx is optimized for sensor readout and power consumption and is not compatible with I²C interfaces, see FAQ for details.

2.2.1 Serial clock input (SCK)

The SCK is used to synchronize the communication between a microcontroller and the SHTxx. Since the interface consists of fully static logic there is no minimum SCK frequency.

2.2.2 Serial data (DATA)

The DATA tristate pin is used to transfer data in and out of the device: DATA changes after the falling edge and is valid on the rising edge of the serial clock SCK. During transmission the DATA line must remain stable while SCK is high. To avoid signal contention the microcontroller should only drive DATA low. An external pull-up resistor (e.g. 10 kΩ) is required to pull the signal high. (See Figure 2) Pull-up resistors are often included in I/O circuits of microcontrollers. See Table 5 for detailed I/O characteristics.

⁽¹⁾ Each SHTxx is tested to be fully within RH accuracy specifications at 25 °C (77 °F) and 48 °C (118.4 °F)

⁽²⁾ The default measurement resolution of 14bit (temperature) and 12bit (humidity) can be reduced to 12 and 8 bit through the status register.

2.2.3 Sending a command

To initiate a transmission, a "Transmission Start" sequence has to be issued. It consists of a lowering of the DATA line while SCK is high, followed by a low pulse on SCK and raising DATA again while SCK is still high.



Figure 3 "Transmission Start" sequence

The subsequent command consists of three address bits (only '000' is currently supported) and five command bits. The SHTxx indicates the proper reception of a command by pulling the DATA pin low (ACK bit) after the falling edge of the 8th SCK clock. The DATA line is released (and goes high) after the falling edge of the 9th SCK clock.

Command	Code
Reserved	0000x
Measure Temperature	00011
Measure Humidity	00101
Read Status Register	00111
Write Status Register	00110
Reserved	0101x-1110x
Soft reset, resets the interface, clears the status register to default values wait minimum 11 ms before next command	11110

Table 2 SHTxx list of commands

2.2.4 Measurement sequence (RH and T)

After issuing a measurement command ('00000101' for RH, '00000011' for Temperature) the controller has to wait for the measurement to complete. This takes approximately 11/55/210 ms for a 8/12/14bit measurement. The exact time varies by up to ±15% with the speed of the internal oscillator. To signal the completion of a measurement, the SHTxx pulls down the data line. The controller must wait for this "data ready" signal before starting to toggle SCK again.

Two bytes of measurement data and one byte of CRC checksum will then be transmitted. The uC must acknowledge each byte by pulling the DATA line low. All values are MSB first, right justified. (e.g. the 5th SCK is MSB for a 12bit value; for a 8bit result the first byte is not used). Communication terminates after the acknowledge bit of the CRC data. If CRC-8 checksum is not used the controller may terminate the communication after the measurement data LSB by keeping ack high. The device automatically returns to sleep mode after the measurement and communication have ended.

Warning: To keep self heating below 0.1 °C the SHTxx should not be active for more than 15% of the time (e.g. max. 3 measurements / second for 12bit accuracy).

2.2.5 Connection reset sequence

If communication with the device is lost the following signal sequence will reset its serial interface: While leaving DATA high, toggle SCK 9 or more times. This must be followed by a "Transmission Start" sequence preceding the next command. This sequence resets the interface only. The status register preserves its content.

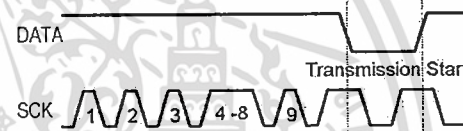


Figure 4 Connection reset sequence

2.2.6 CRC-8 Checksum calculation

The whole digital transmission is secured by a 8 bit checksum. It ensures that any wrong data can be detected and eliminated. Please consult application note "CRC-8 Checksum Calculation" for information on how to calculate the CRC.

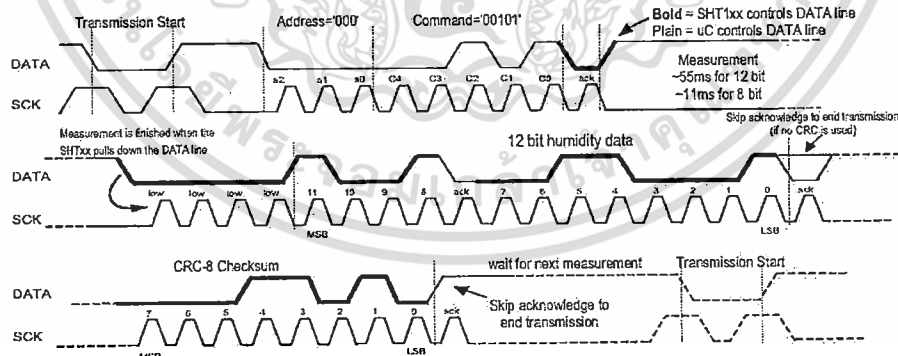


Figure 5 Example RH measurement sequence for value '00001001'0011'0001' = 2353 = 75.79 %RH (without temperature compensation)

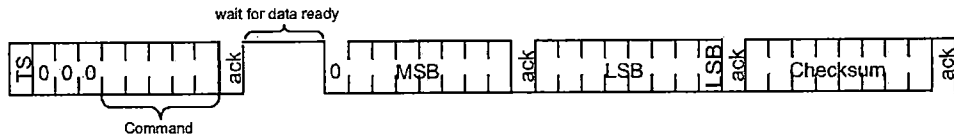


Figure 6 Overview of Measurement Sequence (TS = Transmission Start)

2.3 Status Register

Some of the advanced functions of the SHTxx are available through the status register. The following section gives a brief overview of these features. A more detailed description is available in the application note "Status Register"

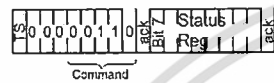


Figure 7 Status Register Write

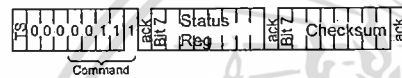


Figure 8 Status Register Read

Bit	Type	Description	Default
7		reserved	0
6	R	End of Battery (low voltage detection) '0' for Vdd > 2.47 '1' for Vdd < 2.47	X No default value, bit is only updated after a measurement
5		reserved	0
4		reserved	0
3		For Testing only, do not use	0
2	R/W	Heater	0 off
1	R/W	no reload from OTP	0 reload
0	R/W	'1' = 8bit RH / 12bit Temperature resolution '0' = 12bit RH / 14bit Temperature resolution	0 12bit RH / 14bit Temp.

Table 3 Status Register Bits

2.3.1 Measurement resolution

The default measurement resolution of 14bit (temperature) and 12bit (humidity) can be reduced to 12 and 8bit. This is especially useful in high speed or extreme low power applications.

2.3.2 End of Battery

The "End of Battery" function detects VDD voltages below 2.47 V. Accuracy is ±0.05 V

2.3.3 Heater

An on chip heating element can be switched on. It will increase the temperature of the sensor by approximately 5°C (9 °F). Power consumption will increase by ~8 mA @ 5 V.

Applications:

By comparing temperature and humidity values before and

after switching on the heater, proper functionality of both sensors can be verified.

- In high (>95 %RH) RH environments heating the sensor element will prevent condensation, improve response time and accuracy

Warning: While heated the SHTxx will show higher temperatures and a lower relative humidity than with no heating.

2.4 Electrical Characteristics⁽¹⁾

VDD=5V, Temperature = 25 °C unless otherwise noted

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Power supply DC		2.4	5	5.5	V
Supply current	measuring		550		µA
	average	2 ⁽²⁾	28 ⁽³⁾		µA
	sleep		0.3	1	µA
Low level output voltage		0		20%	Vdd
High level output voltage			75%		100% Vdd
Low level input voltage	Negative going		0		20% Vdd
High level input voltage	Positive going		80%		100% Vdd
Input current on pads				1	µA
Output peak current	on			4	mA
	Tristated (off)		10		µA

Table 4 SHTxx DC Characteristics

Parameter	Conditions	Min	Typ.	Max.	Unit
F _{SCK}	VDD > 4.5 V			10	MHz
	VDD < 4.5 V			1	MHz
T _{Fall}	Output load 5 pF	3.5	10	20	ns
	Output load 100 pF	30	40	200	ns
T _{Sett}	SCK hi/low time	100			ns
T _V	DATA valid time		250		ns
T _{SU}	DATA set up time		100		ns
T _{H2}	DATA hold time	0	10		ns
T _r /T _f	SCK rise/fall time		200		ns

Table 5 SHTxx I/O Signals Characteristics

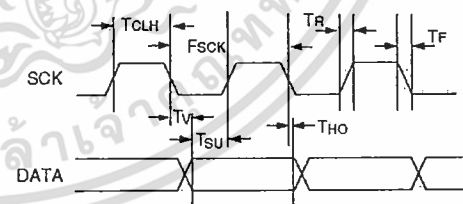


Figure 9 Timing Diagram

¹⁾ Parameters are periodically sampled and not 100% tested
²⁾ With one measurement of 8 bit accuracy without OTP reload per second
³⁾ With one measurement of 12bit accuracy per second

3 Converting Output to Physical Values

3.1 Relative Humidity

To compensate for the non-linearity of the humidity sensor and to obtain the full accuracy it is recommended to convert the readout with the following formula¹:

$$RH_{linear} = c_1 + c_2 \cdot SO_{RH} + c_3 \cdot SO_{RH}^2$$

SO _{RH}	c ₁	c ₂	c ₃
12 bit	-4	0.0405	-2.8 * 10 ⁻⁶
8 bit	-4	0.648	-7.2 * 10 ⁻⁴

Table 6 Humidity conversion coefficients

For simplified, less computation intense conversion formulas see application note "RH and Temperature Non-Linearity Compensation".

The humidity sensor has no significant voltage dependency.

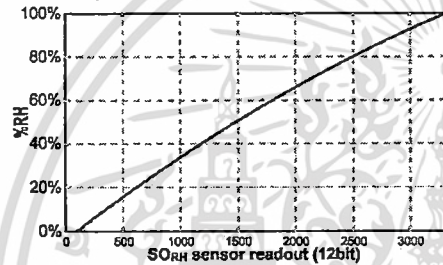


Figure 10 Conversion from SO_{RH} to relative humidity

3.1.1 Compensation of RH/Temperature dependency

For temperatures significantly different from 25 °C (~77 °F) the temperature coefficient of the RH sensor should be considered:

$$RH_{true} = (T_C - 25) \cdot (t_1 + t_2 \cdot SO_{RH}) + RH_{linear}$$

SO _{RH}	t ₁	t ₂
12 bit	0.01	0.00008
8 bit	0.01	0.00128

Table 7 Temperature compensation coefficients

This equals ~0.12 %RH / °C @ 50 %RH

3.2 Temperature

The bandgap PTAT (Proportional To Absolute Temperature) temperature sensor is very linear by design. Use the following formula to convert from digital readout to temperature:

$$Temperature = d_1 + d_2 \cdot SO_T$$

VDD	d ₁ [°C]	d ₂ [°f]
5V	-40.00	-40.00
4V	-39.75	-39.50
3.5V	-39.66	-39.35
3V	-39.60	-39.28
2.5V	-39.55	-39.23

SO _T	d ₂ [°C]	d ₂ [°f]
14bit	0.01	0.018
12bit	0.04	0.072

Table 8 Temperature conversion coefficients

For improved accuracies in extreme temperatures with more computation intense conversion formulas see application note "RH and Temperature Non-Linearity Compensation".

3.3 Dewpoint

Since humidity and temperature are both measured on the same monolithic chip, the SHTxx allows superb dewpoint measurements. See application note "Dewpoint calculation" for more.

¹ Where SO_{RH} is the sensor output for relative humidity

4 Applications Information

4.1 Operating and Storage Conditions

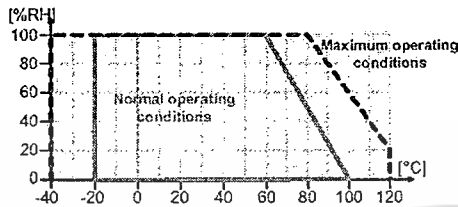


Figure 11 Recommended operating conditions

Conditions outside the recommended range may temporarily offset the RH signal up to ± 3 %RH. After return to normal conditions it will slowly return towards calibration state by itself. See 4.3 "Reconditioning Procedure" to accelerate this process. Prolonged exposure to extreme conditions may accelerate ageing.

4.2 Exposure to Chemicals

Vapors may interfere with the polymer layers used for capacitive humidity sensors. The diffusion of chemicals into the polymer may cause a shift in both offset and sensitivity. In a clean environment the contaminants will slowly outgas. The reconditioning procedure described below will accelerate this process.

High levels of pollutants may cause permanent damage to the sensing polymer.

4.3 Reconditioning Procedure

The following reconditioning procedure will bring the sensor back to calibration state after exposure to extreme conditions or chemical vapors.

80-90 °C (176-194°F) at < 5 %RH for 24h (baking) followed by 20-30 °C (70-90°F) at > 74 %RH for 48h (re-hydration)

4.4 Qualifications

Extensive tests were performed in various environments.

Please contact SENSIRION for additional information.

Environment	Norm	Results ⁽¹⁾
Temperature Cycles	JESD22-A104-B -40 °C / 125°C, 1000cy	Within Specifications
HAST	JESD22-A110-B	Reversible shift by +2 %RH
Pressure Cooker	2.3bar 125°C 85%RH	Within Spec.
Salt Atmosphere	DIN-50021ss	Within Spec.
Condensing Air	-	Within Spec.
Freezing cycles fully submerged	-20 / +90°C, 100cy 30min dwell time	Reversible shift by +2 %RH
Various Automotive Chemicals	DIN 72300-5	Within Specifications
Cigarette smoke	Equivalent to 15years in a mid-size car	Within Specifications

Table 9 Qualification tests (excerpt)

⁽¹⁾ The temperature sensor passed all tests without any detectable drift. Package and electronics also passed 100%

4.5 ESD (Electrostatic Discharge)

ESD immunity is qualified according to MIL STD. 883E, method 3015 (Human Body Model at ± 2 kV).

Latch-up immunity is provided at a force current of ± 100 mA with $T_{amb} = 80$ °C according to JEDEC 17.

See application note "ESD, Latchup and EMC" for more information.

4.6 Temperature Effects

The relative humidity of a gas strongly depends on its temperature. It is therefore essential to keep humidity sensors at the same temperature as the air of which the relative humidity is to be measured.

If the SHTxx shares a PCB with electronic components that give off heat it should be mounted far away and below the heat source and the housing must remain well ventilated.

To reduce heat conduction copper layers between the SHT1x and the rest of the PCB should be minimized and a slit may be milled in between. (See figure 14)

4.7 Materials Used for Sealing / Mounting

Many materials absorb humidity and will act as a buffer; increasing response times and hysteresis. Materials in the vicinity of the sensor must therefore be carefully chosen. Recommended materials are:

All Metals, LCP, POM (Delrin), PTFE (Teflon), PE, PEEK, PP, PB, PPS, PSU, PVDF, PVF

For sealing and gluing (use sparingly):

High filled epoxy for electronic packaging (e.g. glob top, underfill), and Silicone are recommended.

4.8 Membranes

A membrane can be used to prevent dirt from entering the housing and to protect the sensor. It will also reduce peak concentrations of chemical vapors. For optimal response times air volume behind the membrane must be kept to a minimum.

4.9 Light

The SHTxx is not light sensitive. Prolonged direct exposure to sunshine or strong UV radiation may age the housing.

4.10 Wiring Considerations and Signal Integrity

Carrying the SCK and DATA signal parallel and in close proximity (e.g. in wires) for more than 10cm may result in cross talk and loss of communication. This may be resolved by routing VDD and/or GND between the two data signals.

Please see the application note "ESD, Latchup and EMC" for more information.

Power supply pins (VDD, GND) should be decoupled with a 100 nF capacitor if wires are used.

5 Package Information

5.1 SHT1x (surface mountable)

Pin	Name	Comment
1	GND	Ground
2	DATA	Serial data, bidirectional
3	SCK	Serial clock, input
4	VDD	Supply 2.4 – 5.5 V
NC		Remaining pins must be left unconnected

Table 10 SHT1x Pin Description

5.1.1 Package type

The SHT1x is supplied in a surface-mountable LCC (Leadless Chip Carrier) type package. The sensors housing consists of a Liquid Crystal Polymer (LCP) cap with epoxy glob top on a standard 0.8 mm FR4 substrate. The device is free of lead, Cd and Hg. Device size is 7.42 x 4.88 x 2.5 mm (0.29 x 0.19 x 0.1 inch) Weight 100 mg

The production date is printed onto the cap in white numbers in the form wwyy. e.g. "351" = week 35, 2001.

5.1.2 Delivery Conditions

The SHT1x are shipped in standard IC tubes by 80 units per tube or in 12mm tape. Reels are individually labelled with barcode and human readable labels.

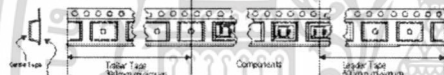


Figure 12 Tape configuration and unit orientation

5.1.3 Mounting Examples

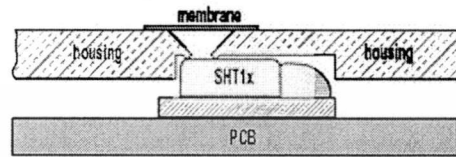
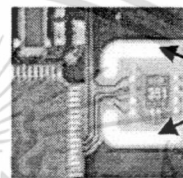


Figure 13 SHT1x housing mounting example



Slit to minimize heat transfer from the PCB

Figure 14 SHT1x PCB mounting example

5.1.4 Soldering Information

Standard reflow soldering ovens may be used at maximum 235 °C for 20 seconds.

For manual soldering contact time must be limited to 5 seconds at up to 350 °C.

After soldering the devices should be stored at >74 %RH for at least 24h to allow the polymer to rehydrate.

Please consult the application note "Soldering procedure" for more information.

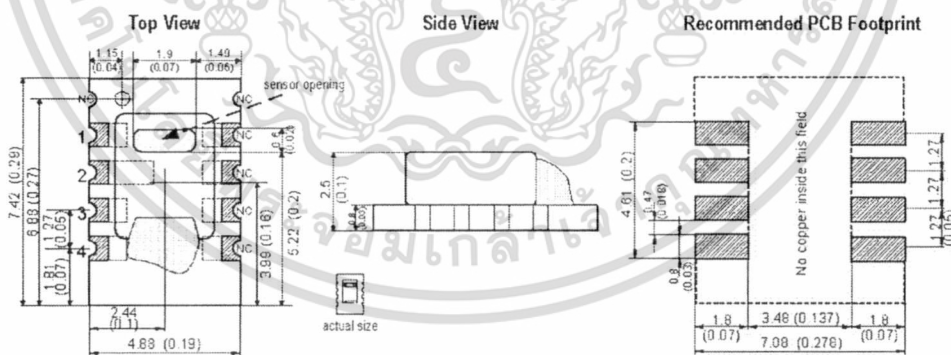


Figure 15 SHT1x drawing and footprint dimensions in mm (inch)

5.2 SHT7x (4-pin single-in-line)

Pin	Name	Comment
1	SCK	Serial clock input
2	VDD	Supply 2.4 – 5.5 V
3	GND	Ground
4	DATA	Serial data bidirectional

Table 11 SHT7x Pin Description

5.2.1 Package type¹

The device is supplied in a single-in-line pin type package. The sensor housing consists of a Liquid Crystal Polymer (LCP) cap with epoxy glob top on a standard 0.6 mm FR4 substrate. The device is Cd and Hg free.

The sensor head is connected to the pins by a small bridge to minimize heat conduction and response times. The gold plated back side of the sensor head is connected to the GND pin.

A 100nF capacitor is mounted on the back side between VDD and GND.

All pins are gold plated to avoid corrosion. They can be soldered or mate with most 1.27 mm (0.05") sockets e.g.: Preci-dip / Mill-Max 851-93-004-20-001 or similar
Total weight: 168 mg, weight of sensor head: 73 mg

The production date is printed onto the cap in white numbers in the form wwy. e.g. *351* = week 35, 2001.

5.2.2 Delivery Conditions

The SHT7x are shipped in 32 mm tape. These reeled parts in standard option are shipped with 500 units per 13 inch diameter reel. Reels are individually labelled with barcode and human readable labels.

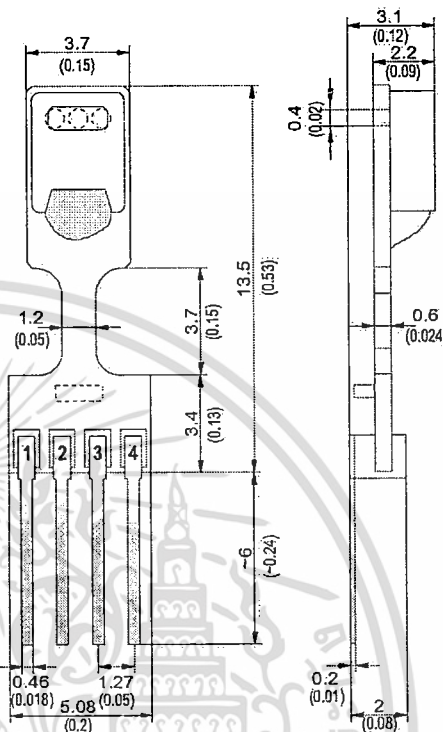


Figure 17 SHT7x dimensions in mm (inch)

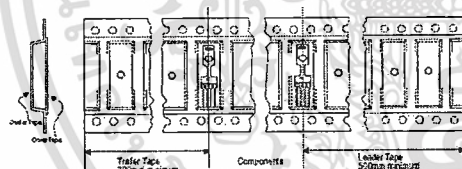


Figure 16. Tape configuration and unit orientation

5.2.3 Soldering Information

Standard wave SHT7x soldering ovens may be used at maximum 235 °C for 20 seconds.

For manual soldering contact time must be limited to 5 seconds at up to 350 °C.

After wave soldering the devices should be stored at >74 %RH for at least 24h to allow the polymer to rehydrate.

Please consult the application note "Soldering procedure" for more information.

¹ Other packaging options may be available on request.

6 Revision history

Date	Version	Page(s)	Changes
February 2002	Preliminary	1-9	First public release
June 2002	Preliminary		Added SHT7x information
March 2003	Final v2.0	1-9	Major remake, added application information etc. Various small modifications
	V2.01	1-9	Typos, Graph labeling

The latest version of this document and all application notes can be found at:
www.sensirion.com/en/download/humiditysensor/SHT11.htm

7 Important Notices

7.1 Warning, personal injury

Do not use this product as safety or emergency stop devices or in any other application where failure of the product could result in personal injury. Failure to comply with these instructions could result in death or serious injury.

Should buyer purchase or use SENSIRION AG products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SENSIRION AG and its officers, employees, subsidiaries, affiliates and distributors harmless against all claims, costs, damages and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that SENSIRION AG was negligent regarding the design or manufacture of the part.

7.2 ESD Precautions

The inherent design of this component causes it to be sensitive to electrostatic discharge (ESD). To prevent ESD-induced damage and/or degradation, take normal ESD precautions when handling this product.

See application note "ESD, Latchup and EMC" for more information.

7.3 Warranty

SENSIRION AG makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does SENSIRION AG assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. "Typical" parameters can and do vary in different applications. All operating parameters, including "Typical" must be validated for each customer applications by customer's technical experts.

SENSIRION AG reserves the right, without further notice, to change the product specifications and/or information in this document and to improve reliability, functions and design.

Copyright© 2001-2003, SENSIRION AG.
All rights reserved.

Headquarters and Sales Office

SENSIRION AG Phone: + 41 (0)1 306 40 00
 Eggböhlstr. 14 Fax: + 41 (0)1 306 40 30
 P.O. Box e-mail: info@sensirion.com
 CH-8052 Zürich <http://www.sensirion.com/>
 Switzerland

Sensirion humidity sensors are available from:

find your local representative at:
www.sensirion.com/rep